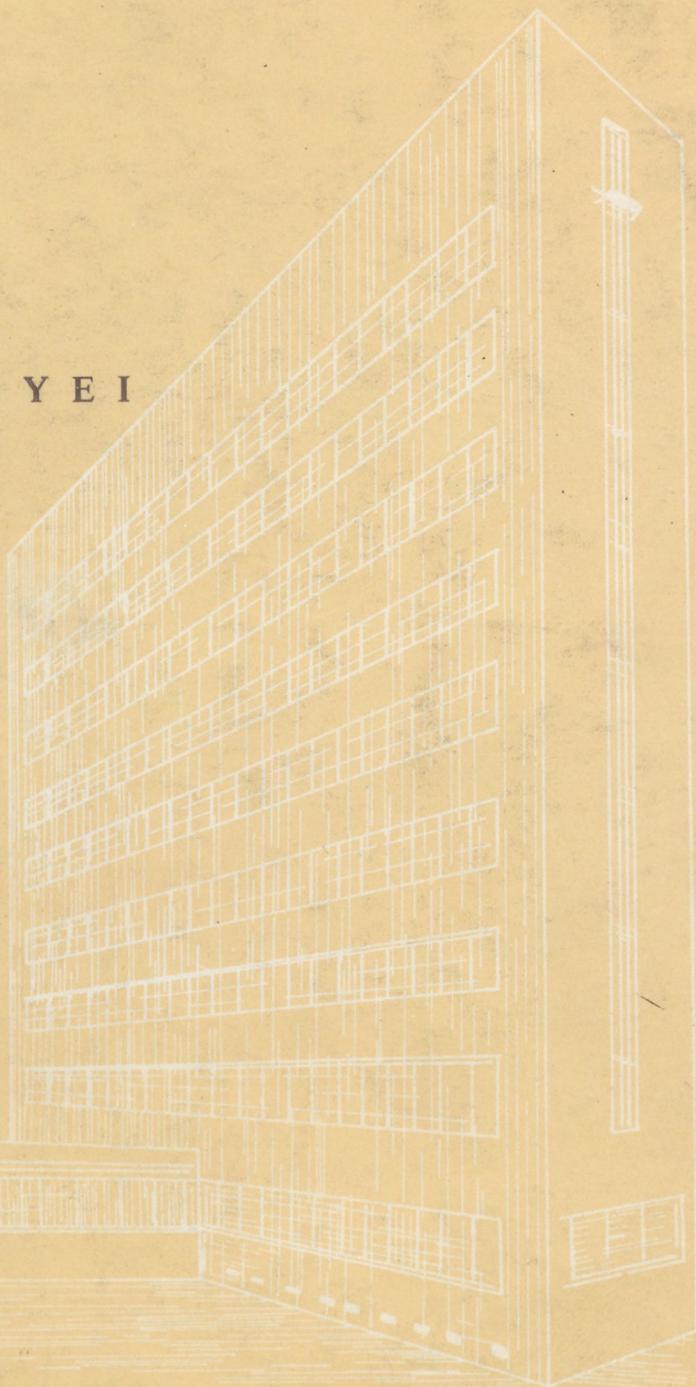


A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA  
MŰSZAKI FIZIKAI KUTATÓ INTÉZETÉNEK



KÖZLEMÉNYEI

0-4





804532

641105

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA  
MŰSZAKI FIZIKAI KUTATÓ INTÉZETÉNEK

KÖZLEMÉNYEI

O - 4.

TANULMÁNYOK A VOLFRÁM KUTATÁS  
TERÜLETÉRŐL

BUDAPEST, 1971

MTA  
KIK



0 00006 48732 4

804232

MAGYAR  
TUDOMÁNYOS AKADÉMIA  
KÖNYVTÁRA.

ИНСТИТУТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ  
ВЕНГЕРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

RESEARCH INSTITUTE FOR TECHNICAL PHYSICS  
OF THE HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES

Budapest, Ujpest 1.Pf. 76.

Felelős kiadó: Szigeti György akadémikus, igazgató;  
Műszaki szerkesztő: Gomperz Istvánné;

VÁTI Rota, 70209, Felelős vezető: Mayer József



2 M. TUD. AKADÉMIA KÖNYVTÁRA  
Könyvtétel 8525 /1971 sz.

## TARTALOMJEGYZÉK

	Oldal
PAPP Attila	
A szinterelés elméletének kérdéseiről	9
KLUG Annamária	
Tetragonális K-W-bronz előállítása és szerkezetének vizsgálata egykristály- diffraktométerrel ... ... ...	37
BUXBAUM Piroska	
Kémiai módszerek a vákuumtechnikai volfrámfém nyomelemeinek analiziséhez	63
GEREY Gyula - HAMMER Ferenc - SZÉNFY Ella	
Néhány megfigyelés gáztöltésű izzólám- pákban fellépő ivkisülésről ... ...	81
NAGY Attila	
Röntgendiffrakciós vizsgálati lehetőség diffuziós folyamatok követésére ...	99

504232

CONTENTS

	Page
A. PAPP	
Some Problems of the Theory of Sintering .....	9
A. KLUG	
Preparation of Tetragonal Potassium- Tungsten-Bronze and Refinement of its Crystal Structure .....	37
P. BUXBAUM	
Chemical Methods for Determination of some Metallic and Non-metallic Traces in Vacuumtechnical Tungsten Metal .....	63
Gy. GEREY - F. HAMMER - E. SZÉNFY	
Some Observations on Internal Arcing Phenomena in Gas Filled Incandescent Lamps .....	81
A. NAGY	
X-ray diffractometric Possibility for the Investigation of Diffusion Processes .....	99

## SOME PROBLEMS OF THE THEORY OF SINTERING

A. PAPP

The paper gives a short review on the theoretical problems of the sintering based on the literature.

There are details on the questions of agglomeration, mechanisme of sintering, activated sintering etc. and also on the up-to-date theories for the explanation of these phenomena.

## PREPARATION OF TETRAGONAL POTASSIUM-TUNGSTEN-BRONZE AND REFINEMENT OF ITS CRYSTAL STRUCTURE

A. KLUG

The structure of the tetragonal potassium-tungsten-bronze, discovered by A. Magneli 20 years ago, has been completed with some new data, measured by an automatic diffractometer and calculated with the IBM-computer. The structure proved to be correct, however the lower limit of the concentration range of the tetragonal phase can be extended ( $x=0.34$ ). This is proved by electron microprobe-analysis, too.

## CHEMICAL METHODS FOR DETERMINATION OF SOME METALLIC AND NON-METALLIC TRACES IN VACUUMTECHNICAL TUNGSTEN METAL

P. BUXBAUM

The vacuumtechnical properties of the tungsten metal depend very much on its impurity content, therefore analytical data on metallic and non-metallic traces are very important.

This short review describes a few chemical-analytical methods related only to certain elements such as Al, K, Si, Fe, Ni, Mo and C. By these methods quantities of  $10^{-4}\%$  can be determined in tungsten metal and tungsten oxides.

For comparison table 1. shows some non-chemical methods and their characteristic data.

SOME OBSERVATIONS ON INTERNAL ARCING PHENOMENA IN GAS  
FILLED INCANDESCENT LAMPS

G.GEREY - F.HAMMER - E.SZENFY

Internal arcing in gas filled coiled-coil incandescent lamps driven by normal lighting mains supply is a major problem accompanying both their production and use.

The physical reasons leading to internal arcing were unknown for a long time. Therefore, we considered the more thorough understanding of the processes involved in arcing by analysing oscilloscope patterns and high speed cinema films. It was concluded that a condition for internal arc development is the simultaneous existence of definite values of voltage and temperature.

As an initial stage of internal arcing the filament is surrounded by a diffuse glow consisting mainly of alkali ions. The concentration of the ions in the hot plasma glow is significant for initiating of the arc.

Due to our results, a slight alkali impurity content is needed to produce internal arcing, therefore in order to reduce its probability, the possible elimination of highly ionizable impurities is suggested.

Several equipments and procedures were developed in our Institute, suitable to reduce the arcing liability of incandescent lamps by decreasing the impurity content or by removing them through sorption processes.

X-RAY DIFFRACTOMETRIC POSSIBILITY FOR THE INVESTIGATION  
OF DIFFUSION PROCESSES

A. NAGY

The diffusion profile may be determined theoretically by means of a simple geometrical model shown in this paper. On the basis of the model the diffraction line is determined by the absorption and by the concentration gradient.

The measurements we have at the present are not accurate enough for quantitative evaluation.

# A SZINTERELÉS ELMÉLETÉNEK KÉRDÉSEIRÖL

PAPP Attila

MTA Műszaki Fizikai Kutató Intézet, Budapest

A munka áttekintést ad a szintereléssel összefüggő problémák elméleti kérdéseiben elérte eredményekről, a rendelkezésre álló irodalom alapján. Az agglomeráció, a szinterelési mechanizmusok és az aktivált szinterelés kérdéseit olyan formában próbálja felvázolni, hogy segítséget nyújthasson a kísérleti munkában.

## BEVEZETÉS

A porok alkalmazása az iparban elsősorban az izzólámpák előállításához szükséges volfrám alapanyag készítéséhez vált szükségessé annak magas olvadáspontja miatt és a magashőméréskerti mechanikai tulajdonságok megfelelő beállítása céljából. Ezt követően kezdték ezt a technológiát széleskörűen alkalmazni a fémkohászatban. Az elméleti kutatások a 20. század első évtizedeiben kezdődtek. Ekkor jelentek meg az első próbálkozások a jelenség tudományos leírására. Az első használható elméleti modell azonban csak 1945-ben jelent meg. Frenkel [1] a newtoni folyást tekintette a szinterelés mechanizmusának, s vele majdnem egyidejűleg Pines, adott ki egy munkát [2], melyben a pórusok "elpárolgását" irja le a Thomson összefüggésből kiindulva. Az alapvető feltételezés minden munkában helyes; a görbült felületek fölös felületi energiájának csökkenése vezet az egyensúly felé és ez szolgáltatja a hajtóerőt az anyagtranszporthoz, és annak egyik lehetséges módja a rács-

diffuziő, melyhez a forrást a pórusok görbült felülete is szolgáltathatja. 1948-ban Nabarró [3], 1950-ben pedig Herring [4] munkája jelent meg, melyben megmutatták, hogy a szilárd kristályos testek folyása nem a Frenkel által feltételezett mechanizmussal történik, hanem olyan folyás-sal, melyet a mozaik blokkok határán és a szemcséhatáron keletkező vakanciák diffuziós árama tart fenn. Kuczinsky 1949-ben megjelent közleménye [5] a két porszem közötti nyak méretváltozását irja le minden mechanizmusra. Ezután nagy lendületet vett a szinterelés kísérleti tanulmányozása és sorra jelentek meg a munkák, melyek a meglévő elméleteket finomították.

### AGGLOMERÁCIO

A szinterelés valamely anyagból készített porszemek összekapcsolódását eredményezi, tehát agglomerációs folyamatnak tekinthető. A folyamat jobb megértése végett áttekinthetjük a jelentősebb összekapcsolódási mechanizmusokat, hogy képet kapunk a szinterelés okozta agglomeráció jelentőségéről.

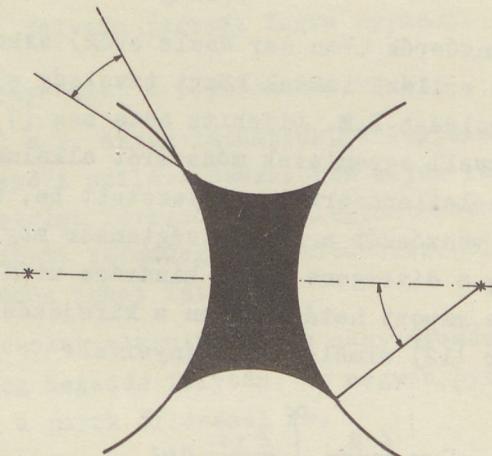
#### 1. Folyadék fázis okozta agglomeráció

Három különböző formája lehetséges: folyadék hidakról beszélünk akkor, ha a folyadék két szemcsét ugy köt össze, hogy a porszemcséknek csak kis részét fedи be. Második esetben a folyadék mintegy átitatja a porszemcsék halmazát, vékony rétegben borítva be azokat. Harmadik pedig az az eset, mellynél a porszemcsék mintegy usznak a folyadékban. A folyadék hidak esetére az összetartó erőt a következő összefüggés adja [6] :

$$F = \gamma \cdot r \cdot f(\delta : \beta)$$

1.

ahol:  $\sigma$  = a felületi feszültség,  $r$  = a porszem sugara,  
 $\delta$  = az érintkezési szög,  $\beta$  = a folyadékkal bőrített rész által meghatározott központi szög  
 (ld. 1. ábra.)



1. ábra

Az  $f(\delta; \beta)$ -ra Fischer  $\delta = 0$  esetében az  $f(\delta; \beta) = 2,2$ -től 2,8-ig terjedő értéket adja a  $\beta$   $10^\circ$  és  $40^\circ$  közti érték változása esetére. Mint a 2. ábrán látható ezek a hidak jelentős szilárdságot biztosítanak.

## 2. Vonzásterők a szilárd részecskék között

Létrejöhet az agglomeráció a szemcsék között mágneses, elektrosztatikus és molekuláris vonzásterők hatására is. Ezen három távolrakható erő közül az első csak mágneses anyagoknál jelentős, ezért azt nem vizsgáljuk meg. Az elektromosan feltöltött szemcsék között az erőt ugy számíthatjuk ki, hogy azok elrendeződését az ionos kristályhoz hasonlónak vessziük.

Ekkor a vonzóerő a következő formában adható meg: [6]

$$F = 0,29 \cdot \pi^2 \varphi^2 d^2$$

2.

ahol  $\varphi$  = a töltéssürűség;  $d$  = a két porszem közötti távolság

A molekuláris vonzóerők (Van der Waals erők) akkor válnak jelentőssé, ha a szilárd testek közti távolság elég kicsi. Az általános megoldást E.M. Lifshitz adta meg [7]. A számításokban a Maxwell egyenletek módszerét alkalmazta, melyekbe különböző véletlenszerű teret vezetett be, és a fluktuačiós eredetű vonzóerőt a feszültségtenzor megfelelő komponense adta meg a divergens tagok kizárása után. A fémekre kis távolságokra kapott határesetben a kifejezés megegyezik a London-Heitler [12] elmélet eredményeivel:

$$F = \frac{4 \pi}{\pi \ell^3} \int_0^\infty \frac{\epsilon + 1}{\epsilon - 1} d\omega$$

3.

ahol:  $\ell$  = a felületek közti távolság,  $\epsilon$  = dielektrikus 100 Å-nél kisebb távolságokra a gömb alaku szilárd testek esetében a molekuláris vonzóerőket a következő kifejezés adja:

$$F = \frac{A \cdot r}{12 \ell^2}$$

4.

ahol:  $A = 10^{-12}$  dyn cm,  $r$  = a részecske sugara.

Ebből kaphatjuk a kifejezést a szilárdságra:

$$\sigma = \frac{4,2 \cdot 10^{-20}}{\ell^2 \cdot r}$$

5.

Ez az erő jelentős a préselés után kapott mintában, mivel ekkor már a porszemcsék deformálódása következtében a fe-

lületeknek nagy része 100 Å-nél közelebb kerül egymáshoz, továbbá kis forméretek esetén.

### 3. Mechanikus összekapcsolódás

Ha a porszemcsék felülete nem sima, vagy alakjuk nem gömbölyű, ugy jelentős összekapcsolódást okoz az, hogy a préselés után ezek a szemcsék összekapcsolódnak, vagy elrendeződésük folytán tartják fogva egymást.

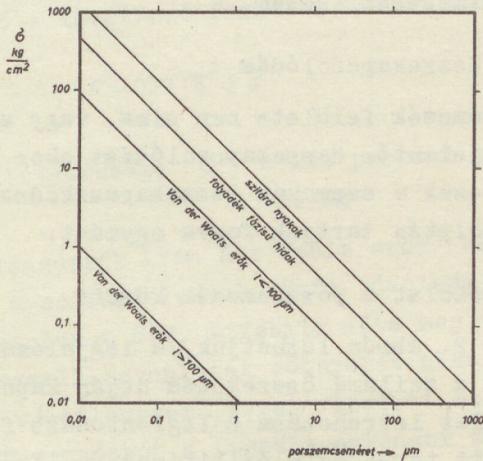
### 4. Szilárd kapcsolat a porszemcsék között

Mint azt a 2. ábrán láthatjuk, a legjelentősebb összekapcsolódás erő a szilárd összekötés utján kapható. Ezért a szilárd kapcsolat létrehozása a legfontosabb feladat a porokból készített termékek előállításakor. Ilyen szilárd hid több féle módon jöhet létre.

Szilárd kapcsolat alakulhat ki a nagy nyomás következtében előálló hideg hegedés folytán. Ez nagyon gyakran előforduló jelenség a porok őrlésénél is.

Ha a porok alkotta mintát oldószerrel itatjuk át, vagy az a mosás során kerül a porokra, ugy az oldószer elpárolgása során kristályosodás indul meg és ez vezet a szilárd hid kialakulásához a porszemcsék között.

A felületeken lejátszódó kémiai reakciók is létrehozhatják azt a szilárd kapcsolatot, ezt sokszor "kémiai szinterelésnek" is nevezik.



2. ábra

A fémek porteknológiájú megmunkálásakor legjelentősebb a szinterelés utján létrejött szilárd kapcsolat. A szinterelésnél az összekapcsolódás a hőkezelés következtében jön létre, különféle anyagtranszport utján. Az alapvető mechanizmusok; a creep, a rácsdiffuzió, a felületi diffuzió, a szemcsehatár diffuzió, és az elpárolgás-lecsapódás után történő anyagtranszport. A szinterelés mértékét elsősorban a kialakult kötés szilárdságával szokás jellemezni, ez adja ugyanis a kapott termék legfontosabb paraméterét. Fizikai szemszögből azonban fontosabbak azok a változások, melyek a méreteknél észlelhetők. Makroszkópikus paraméterként a lineáris méretváltozást (zsugorodást), a minta fajsulyának változását tekinthetjük, mik az utóbbi időben az elektronmikroszkópos mérések lehetővé tették a szemcsék közötti nyakak közvetlen mérését is. Ez lehetővé teszi a különféle mechanizmusok különválasztását és megkapható az összefüggés a nyakméretváltozás és a lineáris zsugorodás között. A sokféle mechanizmus közös vonása az, hogy a felületi állapotok lekállás változása szolgáltatja a hajtó-

erőt az anyagáram keletkezéséhez. Szétválasztásokhoz azt a tulajdonságot használhatjuk fel, hogy az aktivációs energiák jelentősen különböznek és a minta szerkezetétől, anyagától függőek. A szinterelés folyamatát két egymástól jól elválasztható fázisra bonthatjuk. Az első szakasz a kontaktusok kialakulásával kezdődik, majd ezek növekednek, végül a pörusok bezáródásával fejeződik be az a szakasz. A második szakaszban a pörusok bezáródása után azok legömbölyödése, zsugorodása és módoslagos rekristallizáció játszódik le. Ennek alapján minden mechanizmust e két szakaszban játszott szerepe alapján vizsgálunk meg.

#### DISZLOKÁCIOS CREEP

Ahhoz, hogy valamely szilárd testben creep keletkezhessen, valamilyen feszültségeként jelentkező erő jelenléte szükséges. Kétféle külső erő lehetséges a szintereléskor; a gravitációs eredetű és az alkalmazott állandó külső nyomás. Az alkalmazott állandó külső nyomás esetén meleg préselésről beszélünk, mikor ha csak gravitációs erők hatnak kívülről, gravitációs szinterelésről beszélhetünk. A szinterelés egészen korai szakaszában főleg az előzetes megmunkálás vagy préselés következtében létrejött deformációk okozhatnak feszültségeket, melyek a creepet gyorsítják. Legjelentősebb azonban az a hajtóerő, melyet a felületi feszültség okoz és az összes mechanizmusnak ez az alapja. A felületen ható erők a felületi szabad energiával kapcsolatosak, mely a kristályos testeknél nem egyenlő a felületi feszültséggel, mint a folyadékok esetében. Herring mutatta meg, hogy a hibahelyek elrendeződése beleszól a felületi energia nagyságába és mivel az előző a felületi konfigurációtól függ, az utóbbi is a szabad felület függvénye lesz. Az 1-100  $\mu\text{m}$  átmérőjű porok esetében a szabad felület áriási nagy, és

a felületi görbületek is rendkívül változóak. Ez különbségeket okoz a felületi feszültségen a minta különböző pontjaiban. Ezeknek a feszültségeknek kiszámításához a virtuális munkát használjuk, azaz a teljes felületi energia változását számítjuk ki és ez erőt ad. Gömbalakunak véve a szemcséket ez az erő a következő képpen adható meg:

$$F = - \frac{d}{dr} 4\pi r^2 \gamma \quad 6.$$

ahol:  $\gamma$  = az egységnyi felület energiája;  
 $r$  = a részecske sugara.

Ha egyidejűleg több erő is hat a mintában, az előbb felsorottak közül, akkor ezeket vektoriálisan kell összegezni. A deformáció nagysága csak az alkalmazott feszültségek nagyságától függ, attól azonban, hogy ezeket milyen hajtóerők produkálják, nem függ.

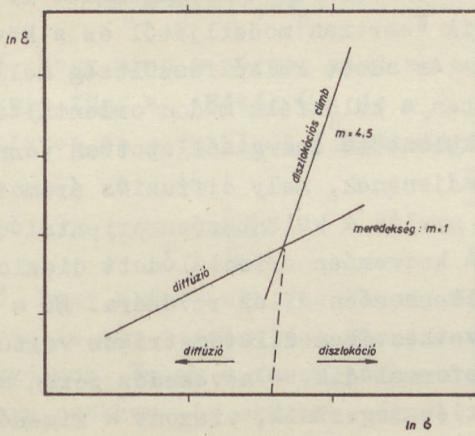
### 1. Diszlokációk szerepe a szinterelés első szakaszában

Általánosan elfogadott vélemény az, hogy a szinterelésnél a legjelentősebb anyagtranszportot a diffúzió hozza létre, de ma már egyre inkább világossá válik, hogy a diszlokációk szerepét sem szabad elhanyagolni sem a kezdeti, sem a későbbi szinterelési folyamatoknál. A hajtóerőt ekkor is a görbületi sugarak közti különbség okozta feszültségek hozzák létre. Az első szakasz modelljét a 3. ábrán láthatjuk. Ennek alapján:

$$\sigma = \gamma \left( -\frac{1}{\varrho} + \frac{1}{x} \right) \quad 7.$$

ahol:  $\varrho$  és  $x$  a görbületi sugarak, mint azt az ábra mutatja;  $\gamma$  a felületi feszültség (ez magas hőmérsékleten közel azonos a felületi energiával). Ez a feszültség kis nyaksugár setében elég nagy lehet ahhoz, hogy diszlokációs mo-

gást hozzon létre. Weertman [8] a diszlokációs anyagtranszportra a következő modellt írja le: a nyírfeszültség hatására diszlokációk keletkeznek a nyakban valahol és a csuszósíkok mentén mozognak mindaddig, amíg találkoznak a másik csuszósíkon mozgó ellentétes előjelű diszlokációval. Ekkor a vonzóerő miatt addig állnak szemben egymással, míg nem átugrásokkal közeledve egymáshoz megsemmisülnek. Amint az annihiláció megtörtént, újabb diszlokáció keletkezhet a nyakban lévő forráshelyek egyikén. Ez tehát olyan dinamikus egyensúlyi állapotot jelent, melyben minden ugyanannyi diszlokáció mozog és három különböző folyamat: diszlokáció keletkezése, mozgása és climbje játszódik le. Ezek közül a



3. ábra

leglassabb folyamat a climb, ezért ez fogja meghatározni az egész folyamat gyorsaságát. A diszlokáció climbjéhez az kell, hogy egy vakanciát fogjon be, vagy szabadítson fel. A vakancia keltéséhez a hajtóerőt a csuszósíakra normális feszültségek komponens okozta kémiai potenciálgradiens szolgáltatja. Igy a diszlokációs climb gyorsasága arányos a fém öndiffuziós köefficiensével. Ebből a modellből azt

kapjuk, hogy a creep okozta deformációsebesség a következő lesz:

$$\dot{\epsilon} = K \frac{\sigma^{4,5}}{T} \exp \left( -\frac{Q}{RT} \right)$$

8.

ahol:  $K$  = tartalmazza az összes faktort, mely független a feszültségtől és a hőmérséklettől,  $Q$  = az öndiffuziós aktivációs energiája (ld. 3. ábra).

Azon a kristályon, melyben ilyen folyamatok játszódnak le, láthatóak a diszlokációk felületre való kimenésének nyomai, mint kis kiemelkedések.

Ez a folyamat erősen érzékeny a felületi állapotra. Kosevich és Slezov [9] olyan diszlokációs mechanizmust ír le, mely teljesen különbözik Weertman modelljétől és a következő el-képzést elemzik: Az adott külső feszültség mellett, stacionárius állapotban a különféle módon orientálódott diszlokációs gyűrük, különböző energiaállapotban vannak. Ez az oka a potenciálgradiensnek, mely diffuziós áramot kelt. A forráshelyek és a nyelők a különbözően orientálódott diszlokációs gyűrük. A kedvezően orientálódott diszlokációs gyűrük tágulnak az ellenkezően állók rovására. Ez a sikok közti diffuziós áram következtében dilatometrikus változáshoz vezet, a kristály deformálódik. A növekedés során a gyűrű eléri a kristály határát és megszűnik, viszont a kimenő diszlokációk helyett a Frank-Read források ujakat termelnek, és így dinamikus egyensúly áll be.

Ezeket a mechanizmusokat elsősorban a kezdeti szakaszban le-játszódó folyamatokra (nyakasodás) és a kis külső nyomás mellett történő szinterelésre alkalmazzák.

## 2. Diszlokációk a szinterelés második szakaszában

Hingorany és Hirschdorn [10] azt az elképzést vázolják, miszerint a szinterelés késői szakaszában a diszlokációs mechanizmus jelentős. A számításokban a Weertman egyenletre támaszkodnak, és a következő feltételezéseket teszik: Az anyag, amely a pórust tartalmazza, homogén, izotróp a pórus gömb alaku. Az ő levezetésüköt követve nézzük át ezt a kérdést. A pórus térfogata:

$$V_p = \frac{4}{3} \pi r_p^3 \quad 9.$$

ahol:  $r_p$  = a pórus sugara. A pórust tartalmazó anyag térfogatát abból a feltételezésből kaphatjuk, hogy a creep csak egy kis  $r_v$  környezetben játszódik le. Igy:

$$V_v = \frac{4}{3} \pi (r_v^3 - r_p^3) \quad 10.$$

Megjegyzendő, hogy mind a pórus, mind az azt körülvevő anyag térfogata függ az időtől ( $r_p$  és  $r_v$ ). A pórus felületével kapcsolatos és a felületi feszültségből származó feszültség:

$$\sigma_p = \frac{2 \tau}{r_p} \quad 11.$$

Megjegyzendő, hogy a felületi feszültség más, ha "Vakuum" van a pórusban és más a jelentése gáz jelenlétében, melyet itt nem vizsgálunk. Ennek a feszültségnek a következtében a pórus sugara csökken. Az eközben végzett munka:

$$W = -4 \pi r_p^2 u_p^2 \sigma_p \quad 12.$$

ahol:  $u_p$  = a pórus felületének sugárirányú sebessége. A környező anyag teljes energia elnyelése a plasztikus folyás következtében:

$$M = \dot{\Sigma} \sigma \frac{4}{3} \pi (r_v^3 - r_p^3)$$

Ahol  $\dot{\Sigma}$  = a deformáció mértéke. Mivel mind a feszültség, mind a deformáció mértéke  $r$  - függvénye ( $r$ - a távolság a pórus középpontjától):

$$M = 4 \int_{r_p}^{r_v} \dot{\Sigma} r^2 dr$$

13.

Weertman szerint

$$\dot{\Sigma} = K \sigma^{4,5} \frac{D_v}{T}$$

14.

ahol  $K$ - mint a (8)-ban.  $D_v$  - az öndiffuziós állandó. Ennek segítségével:

$$M = \frac{4\pi T}{KD_v} \frac{1}{1/4,5} \int_{r_p}^{r_v} \dot{\Sigma} r^{5,5/4,5} r^2 dr$$

15.

kifejezés kapható. A kristályos testek összenyomhatatlanságát felhasználva a sugárirányú sebességekre azt kapjuk, hogy az arányos a középponttól mért távolsággal:

$$U_r = U_p r_p^2 / r^2$$

16.

A sugárirányú sebesség és a deformáció mértéke a meghatározásukból;

$$U_r = \frac{dr}{dt} \text{ és } \dot{\Sigma} = - \frac{dr}{r^2 dt}$$

17.

Igy:

$$\dot{\Sigma} = - \frac{U_p r_p^2}{r^3}$$

18.

Mindezek felhasználásával és az integrálás után:

$$M = \frac{-6\pi \left( U_p r_p^2 \right)^{5,5/4,5} - \frac{2}{r_p^3} \left[ 1 - \left( 1 - D \right)^{2,5} \right] T^{1/4,5}}{\left( D_r \cdot K \right)^{1/4,5}}$$

19.

Ennek egyenlőnek kell lennie a felület mozgása következtében felszabaduló energiával

Ebből megkapható a pórus zsugorodásának mértéke:

$$U_p = \frac{264 \sqrt[4.5]{r_p^{-3.5} D_v} \left[ 1 - (1-D)^{2/9} \right]}{\mu^{3.5} (b \cdot m)^{0.5} kT} \quad 20.$$

ahol:  $D = 1 - (r_p/r_v)^3$  az elméleti sűrűség aránya,

$b$  = a Burgers vektor,  $m$  = a diszlokáció források sűrűsége,  $\mu$  = a nyirási modulus

Ez az eredmény különbözik a korábban kapott eredményektől abban, hogy a pórusok zsugorodásának mértéke függ a nyirási modulustól. Ez több fontos következménnyel jár. Igy: a diszlokációs mozgást megkönnyíti a nyirási modulus alacsony értéke, és a képletből látható, hogy a gázatmoszféra hatása minden jelentős lehet a szinterelés mértékére nézve. Másik fontos következmény abból folyik, hogy a nyirási modulus hőmérsékletfüggő mennyisége, akár a diffuziós állandó, vagy a felületi energia. Ez módosithatja a hőmérsékletfüggés képét.

#### NABARRO - HERRING MIKROCREEP

Amint az a bevezető részben is olvasható, Nabarro [3] és Herring [4] adták az első helyes leírást a kristályos testek szinterelésére, melyet a diffuziós creepnek tulajdonítottak. Megmutatták azt, hogy a Frenkel-féle modell csak az amorf szilárd testeknél ad helyes eredményt, mik a kristályos anyagok nem a Newton folyásnak megfelelően deformálódnak, hanem a strukturájuktól függően, amely viszont az időtől függő. Erre a creep mechanizmusra az jellemző, hogy a yakancsok diffuziós árama korlátozza,

mely a kristályban a kémiai potenciálgradiens hatására jön létre:

$$\dot{J} = -D_{\text{vak}} \nabla \xi$$

21.

ahol:  $D_{\text{vak}}$  = a vakanciák diffuziós együtthatója az adott kristályban,  $\xi$  = a lokális vakancia koncentráció.

$$\nabla \xi = \frac{\xi_0}{kT} \nabla \varphi$$

22.

$\xi_0$  = az egyensúlyi vakancia koncentráció,

$\nabla \varphi$  = kémiai potenciálgradiens

A kémiai potenciálgradiens inhomogén, vagy anizotrop feszültség miatt jöhet létre a szinterelés alatt.

Ez utóbbi esetében a strukturális kristály egységek határain megadott határfeltételek szabják meg a belső kémiai potenciál eloszlást és ahhoz, hogy potenciálgradiens keletkezzen, elegendő ha a határonkon lokálisan változik a normálirányú feszültséggkomponens:  $\sigma_n$ . Ez okozza aztán a hely szerint változó vakanciaelosztást:

$$\xi = \xi_0 \left( 1 + \frac{\Omega}{kT} \sigma_n \right)$$

23.

ahol:  $\Omega$  = az atomi térfogat

A Nabarro-Herring mikrocreep alapvető ideája abban áll, hogy a creephez szükséges diffuziós áram vakanciáit a kristályban található szemcsék, blokkok és mozaikblokkok határai termelik és nyelik el. Ezeket az egységeket valamelyen lineáris mérettel  $\ell$  jellemezhetjük, mely az átlagos méretet jelentheti, pl. a külső nyomás irányában, de amely minden esetre nagyon struktura érzékeny változó. Ez a lineáris méret, valamint a vakanciaforrásként és vakancianyelőként szolgáló határ közti vakancia koncentráció különbség

segítségével adható meg a koncentrációgradiens:

$$\nabla \xi = \frac{\Delta \xi}{\ell} \quad 24.$$

Az így keletkező diffuziós anyagáram vezet aztán az adott egység (szemcse, blokk, mozaikblokk) formájának megváltozáshoz. Az anyagáram ennél a modellnél az adott egység belsőjében folyik, a makroszkopikus, azaz az egész mintát átfogó anyagáram a mintán belül található nyelők miatt nem lehetséges. A kristály egységeinek deformálódása a mikrocreep következtében csak olyan formában történhet, hogy a határokon ne keletkezhessenek repedések. Ezért minden egyes részdeformáció függvénye a környező részek deformációjának. Az ilyen creep eredményeként az egész kristály deformálódik, a reá ható feszítőerőktől függően. I.M. Lifshitz munkájában [1] polikristályos test mikrocreepjét számolta, a diszlokációs szemcsehatárokat véve egyedi forráshelyeknek és nyelőknek az anyagtranszport számára, megadva azok alakját is. Eszerint a deformáció sebességét a következő összefüggés adja meg:

$$\dot{\epsilon} \sim \frac{D_V \Omega}{k T \ell^2} \sigma \quad 25.$$

ahol:  $D_V = \xi \cdot D_{vak}$

Ebből leolvashatjuk a viszkozitás állandóját:

$$\gamma \sim \frac{\ell^2 k T}{D_V \Omega} \quad 26.$$

Ahhoz, hogy valamilyen diszlokációs határ vakanciaforrás, vagy nyelő legyen, a következő feltétel kell:

$$\frac{\theta^2}{\ell \ln \theta} \gg \frac{b}{\ell} \quad 27.$$

ahol:  $\theta$  = a szemcsék orientációja által bezárt szög,  
 $b$  = a Burgers vektor,  $\ell$  = a szemcsék lineáris  
 mérete

A folyamat fennmaradásához szükséges, hogy a feszültség-különbségek a különböző szemcsehatárokon megmaradjanak. Ehhez viszont az kell, hogy az oldalsó határok egymáson elcsuszassanak, azaz, hogy a kapcsolat közöttük elégé laza legyen. Ha ezt figyelembe vesszük, akkor az előző határfeltételeket szigorubbá kell tennünk. Az új határfeltétel így néz ki:

$$\theta^2 \gg \frac{\ell}{\ell}$$

28.

A magas hőmérséklet ( $T \sim 0,9 T_{\text{olv.}}$ ) és ez a határfeltétel kell ahhoz, hogy a Nabarro-Herring creep a kristályban létrejöjjön. Ha a kristályban nincs olyan határ, mely ezt a feltételezett kielégíti, akkor a kristály a diffuzió szempontjából egykristálnak tekinthető és a forráshelyeknek és nyelőknek a minta határai tekinthetők, azaz a diffuziós mechanizmus utján folyik a szinterelés.

A Nabarro-Herring mikrocreep eddigi tárgyalásánál eltekintettünk attól, hogy a rácsdiffuzió mellett a szemcsék határán lejátszódó diffuzió is jelentős anyagtransportot okoz és így hozzájárul a szemcse, vagy blokk formájának megváltozásához. Ha feltételezzük, hogy a kétféle mechanizmus kölcsönhatása nem jelentős, azaz azokat additivnek tekinthetjük, akkor a viszkozitás állandója a következő lesz:

$$\eta = \eta_0 \left( 1 + \frac{D_b \delta}{D_v \ell} \right)^{-1}$$

29.

ahol:  $D_b$  = a szemcsehatár menti diffuzió együtthatója  
 $\delta$  = az a kb. egy rácsállandónyi réteg a határ alatt, melyben a szemcsehatárdiffuzió lejátszódik.

Ha a polikristályos minta szemcsézete nagyon apró, ( $\ell < 10^{-3}$  cm) akkor a határok menti diffuzió elnyomja a

rácsdiffuziót és a szemcse deformálódása a következő viszkozitási állandóval történik:

$$\eta \sim \eta_0 \frac{D_v \ell}{D_b S} \quad 30.$$

A fent leírt mechanizmus jó alkalmazható a kristályos testben található pórus zsugorodás leírására abban az esetben, ha a pórus mérete a mintára jellemző szemcsemérethez képest nagyon nagy. Ebben az esetben a pörust sok szemcse és szemcsehatár veszi körbe és a szemcsék Nabarro-Herring creepje folytán azok ugy deformálódnak, hogy a pórusba mintegy "belefolynak". Két különböző esetet kell megvizsgálni ennél a folyamatnál. Az első esetben a külső nyomás jelentéktelen. Ekkor:

$$R = R_o - \frac{\gamma t}{\eta} \quad 31.$$

ahol:  $\gamma$  = a felületi feszültség,  $\eta$  = a viszkozitás állandója (ld. fentebb).

Ez az egyenlet írja le a pórus sugarának zsugorodását. Ha a külső nyomás nagy, kapjuk a második esetet. Ebben az esetben a méretváltozást a következő egyenlet adja: [13]

$$R = R_o \left(1 - \frac{Pt}{2\eta}\right) \quad 32.$$

ahol:  $P$  = a külső nyomás.

Amint a pórus mérete kisebbé válik a szemcsék méreténél, ez a folyamat tovább nem működik jelentős mértékben, viszont megkezdődik a pórus kiuszása a szemcsék deformálódása következtében. A fent leírt creep hatására bekövetkező pórus zsugorodás következtében a minta lineáris változása játszódik le, valamint rövidkönig a sűrűsége.

Az eddig kapott eredmények a szinterelés második szakaszában lejátszódó folyamatokat mutatták be. Hogy az első szakasz megvizsgálhassuk, két gömb alaku szemcse közötti nyak átmérőjének változását kell kiszámítani. Tegyük fel, hogy a mintára külső F erő hat, mely a porszemcséket egymáshoz nyomja. Ebben az esetben a nyak sugarának megváltozását az:

$$\dot{x} = \frac{2 R_0^2}{x^3 \eta} \cdot \frac{F}{\pi} \quad 33.$$

egyenlet adja. Ahol:  $x$  = a nyak sugara,  $R_0$  = a kezdeti részecskesugár.

Az integrálás után:

$$x^4 = \frac{8 R_0^2 F}{\eta \pi} t \quad 34.$$

egyenletet kapjuk a nyakasodás mértékére.

#### Anyagtranszport elpárolgás-lecsapódás utján

A magas hőmérsékleten történő szintereléskor az anyag egyensúlyi gőznyomása elég jelentős lehet ahhoz, hogy a párolgás-lecsapódás megfelelő hajtóerő jelenlétében jelentős anyagtranszportot képviseljen. A pára rugalmassága függ a felület görbületétől, ennek következtében a domboru felületeken az anyag elpárolog, a homorú részekben pedig lecsapódik. A szinterelés kezdeti szakaszában ez a folyamat a porszemcse domboru felületéről a nyak kis görbületi sugarú homorú felületére szállítja az anyagot. Igy a nyak sugara növekedik, de lineáris méretváltozás a minta egészében ennek következtében nem történik. A folyamat erősen függ a szabad uthossztól. Vakuumban, ahol a szabad uthossz jelentős, a következő lesz a nyakasodás egyenlete [14]

$$\dot{x} = \left( \frac{m}{kT} \right)^{0.5} \frac{P_0 \sqrt{2} R_0}{d^2 x^2 \sqrt{2\pi}} \quad 35.$$

ahol:  $m$  = atom tömege,  $d$  = sűrűség szilárd állapotban,  
 $R_0$  = a porszemcse sugara,  
 $P_0$  = adott hőmérsékleten a pára egyensúlyi rugalmas-sága

Az integrálás elvégzése után

$$x^3 = 4.3 \left( \frac{m}{\pi^{1/3} kT} \right)^{3/2} \frac{\sqrt{P_0 R_0}}{d^2} t \quad 36.$$

Ha a szinterelés külső gáztérben történik, melynek nyomása  $P$ , az összefüggés így változik meg:

$$x^5 = \frac{8.5 P_0 R_0^2 a^4}{\pi (m k T)^{0.5} P} \quad 37.$$

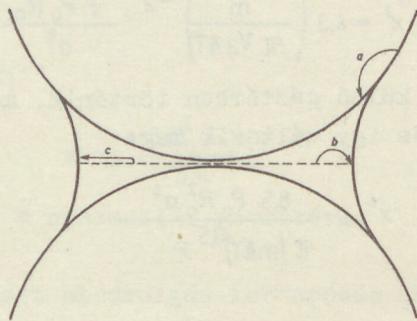
$a$  = rácsállandó.

A szinterelés második szakaszában az elpárolgás-lecsapódás anyagtranszport a pörusok bezáródása utáni nem egyensúlyi pörusforma változását segíti elő, míg nem az eléri az egyensúlyi formát (legömbölyödés). Ez akárcsak az első szakaszban, nem jár együtt lineáris méretváltozással.

### RÁCSDIFFUZIOS MECHANIZMUS

A fentiek során már olyan gyakran említettük a különféle mechanizmusoknál, hogy az adott folyamatot a rácsdiffuzió gyorsasága korlátozza, hogy tisztáznunk kell, mit nevezhetünk ezek után rácsdiffuziós mechanizmusnak. A szinterelés minden szakaszában azt a folyamatot nevezzük rácsdiffuziós szinterelési mechanizmusnak, amikor a diffuziós folyamat forráshelyei és nyelői a porszemcsék felületei.

Ez tehát magában foglalja azt az esetet is, mikor a diffuziós forráshelyéül a két porszemcse érintkezési helyén a nyakban keletkezett szemcsehatár szolgál, ha a nyelő a nyak felülete. Ugyanigye ehhez az esethez tartozik az is, mikor a mintában található pórus a forráshely és a minta felülete a nyelő, vagy másik pórus a nyelő (ld. 4. ábra).



4. ábra

A 4. ábrán látható (a) nyil által jelölt folyamatban a diffuziós áram a porszemcse domború részétől a nyak homorú felületére szállítja az anyagot. A két hely közötti vakancia-koncentráció különbséget a következő képlet adja:

$$\Delta \xi = \xi_0 \frac{\gamma \Omega}{kT} \left( \frac{1}{r} - \frac{1}{x} \right) \quad 38.$$

Ennek következtében lineáris zsugorodás a mintában nem történik, a folyamat a nyak sugarának növekedéséhez vezet, melynek egyenlete:

$$x^5 = \frac{68 \gamma D_v R_0^2 \Omega}{kT} t \quad 39.$$

A második esetben (b) a nyakba lévő a két porszemcsét elválasztó szemcsehatár és a nyak felülete között a rácson

át történik a diffuziós transzport, aminek következtében a nyak vastagodása mellett még a két porszemcse közeledése is megfigyelhető. A nyakméretváltozást az előzőhöz hasonló

$$x^5 \sim t \quad 40.$$

Összefüggés adja meg közel azonos számegyütthatóval, mig a lineáris zsugorodást a következőképpen kaphatjuk:

$$y = R_0 \left( \frac{2,5 \sqrt{\Omega} D_v}{2 \pi T R_0^3} \right)^{2,5} \cdot t^{2/5} \quad 41.$$

ahol:  $y$  - a két porszemcse központját elválasztó távolság megváltozása.

Ha a görbületi sugarak különbözők között kivül még külső erő is hat a mintára, ugy ennek hatását is figyelembe kell venni.

Ha ez az erő nem elég nagy ahhoz, hogy a diszlokációk mozgását okozza, akkor a Herring-Nabarro creep és a rácsdiffuzió után történik a deformálódás. Az elsőt ezek közül már korábban megvizsgáltuk, most nézzük meg a másodikat.

A nyak közelében az  $F$  külső erő által létrehozott feszültség:

$$\sigma_0 = \frac{3F}{\pi x^2} \quad 42.$$

Ennek következtében diffuziós áram lép fel, mely a nyak növekedéséhez vezet:

$$x^4 = \frac{12 D_v \sqrt{\Omega} F}{\pi k T} t \quad 43.$$

mely folyamat egyidejűleg hat a görbületi sugár miatt fél-lépő diffuziós áramlattal. A kettő közötti versengés akkor dől el a külső erő okozta növekedés javára, ha a külső erő tulhalad egy bizonyos kritikus nagyságot:

$$F_{kr.} = \frac{R_0^2 \gamma}{x} \quad 44.$$

A külső erő okozta lineáris méretváltozás nagyságát is megkaphatjuk:

$$\gamma = \frac{0,75}{R_0} \left( \frac{D_V \Omega F}{\pi k T} \right)^{1/2} t^{1/2} \quad 45.$$

A szinterelés második szakaszában a rácsdiffuziós mechanizmus akkor jelentős a pörusok feloldásában, ha a (28) felvétel szerint a szemcsehatárok nem lehetnek nyelők a vakanciák számára. Ebben az esetben a pörusok összegyülése és "kipárolgása" játszódik le. A pörus görbületi sugara miatt a felülete közelében nagy mértékben megnövekedik a vakancia-koncentráció, ez pedig azt eredményezi, hogy diffuziós áram indul meg a felületre. Hasonlóan, mint korábban, itt is két esetet kell megkülönböztetni. Az első esetben a külső nyomás elhanyagolható és ekkor:

$$R^3 = R_0^3 - \frac{6 D_V \gamma}{k T} t \quad 46.$$

ahol:  $R_0$  = a pörus eredeti sugara.

Ha a külső nyomás jelentékeny nagyságu, akkor az egyenlet megváltozik:

$$R^2 = R_0^2 - 2 D_V \left( \frac{\Omega F}{k T} - \frac{\Delta}{\xi_0} \right) t \quad 47.$$

ahol:  $\Delta$  = a vakanciatultelitottság

$\xi_0$  = az egyensúlyi vakancia-koncentráció sik felület alatt.

Az ilyen folyamat a minta sürűségének megváltozásához vezet, és változik a minta lineáris mérete is. Ha a pörusokba az atmoszférából gáz záródik be, ez jelentősen módosítja a pörus viselkedését. Ezt részletesen Coble tárgyalja [15]. Feltételezhetően ebben az esetben a pörus kiuszása a fennálló feszültségradiens hatására marad a lehetséges mód, mivel a gáznyomás miatt a pörus csökkenése megáll és van ideje arra, hogy a felületre még egész kímenjen.

SZEMCSEHATÁRDIFFUZIO ÉS FELÜLETI DIFFUZIO  
A SZINTERELÉSBEN

A szinterelés kezdeti szakaszában a nyakasodáskor linéaris méretgyalozás csak annak a következtében keletkezhet, hogy a nyakban létrejött szemcsehatárról rácsdiffuzió, vagy szemcsehatármenti diffuzió után anyagtranszport indul a nyak felületére. Ez a két folyamat külön is leirható, de az ujabb digitális számítógéppel végzett analízis lehetővé tette, hogy a két folyamatot együtt vizsgáljuk. Ezt a vizsgálatot a lineáris zsugorodásra Johnson és munkatársai végezték el [17]. Ha a modellt gömbalaku szemcsékből állónak vesszük, elég messze kerülünk a reális kísérleti körülményektől. Johnson és Cutler azonban ugy találták, hogy ha a szemcsék méreteloszlása egyenletes, akkor a formájuk okozta hiba menetközben korrigálható minden az idő, minden a lineáris zsugorodás esetében. Ez a korrekció csak a por fajtájától függő, a hőmérséklettől nem. Ennek segítségével Johnson és Clarke [16] megmérték minden a rácsdiffuzió, minden a szemcsehatárdiffuzió állandóját az eziüstre, mely más méresekben is ismeretes volt. Az ilyen alapon nyugvó zsugorodási egyenletet Berrin és Johnson a következő formában adták meg:

$$\frac{x^3 \dot{y}}{x - \delta} = \frac{2 \gamma \Omega D_V}{\pi k T R^3} \frac{A}{a} + \frac{4 \gamma \Omega \delta D_b}{k T R^4} \quad 48.$$

ahol:  $R$  = a részecske sugara,  $x$  = a nyak sugara,

$\delta$  = a nyak kifelé álló görbületi sugara,

$A_V$  = a nyak felszinének területe,

$y$  = a relativ zsugorodás,

$\Omega$  = az a kb. egy rácsállandónyi távolság, melyben a szemcsehatárdiffuzió lejátszódik.

A nyakasodás mértékét a szemcsehatárdiffuzió következtében a következő egyenlet adja:

$$x^6 = R_o^2 \frac{48 \delta D_b \gamma \Omega}{\pi kT} t \quad 49.$$

A szinterelés második szakaszában lejátszódó pöruszsugorodásban is jelentős szerephez juthatnak a szemcsehatárok. Coble [18] vizsgálta a szemcsehatárok és a pörus kölcsönhatását. Kakar pedig olyan egyenleteket kapott, melyek figyelembe veszik a kristály szerkezetét, mely nagyon fontos szerepet játszik itt. Az így kapott egyenlet a pörus térfogatváltozásra a következő [19] :

$$P_c = K_1 \left( \frac{D_b \delta \gamma \Omega}{\ell^4 kT} t \right)^{2/3} \quad 50.$$

ahol:  $P_c$  = a pörus térfogatváltozása,  
 $\ell$  = a polihedron érhossza,  
 $K_1$  = konstans, mely kocka kristályra: 85  
 dodekaéderre: 37.

A felületi diffuzió szerepe különösen a nyakasodásnál lehet jelentős. A felületi elnevezés ugyan arra engedné következtetni, hogy a diffuzió a felületen történő migráció utján történik, de a valóságban a jelenség a felület alatti kb. egy rácsállandónyi rétegben játszódik le. A nyakasodás a felületi diffuzió következtében a következő egyenettel írható le:

$$x^6 = R_o^2 \frac{116 \Omega \delta D_s \gamma}{kT} t \quad 51.$$

ahol:  $D_s$  = a felületi diffuzió állandója.

A felületi diffuzió nagyon érzékeny a felületi állapotra, valamint az atmoszférára, melyben a szinterelés történik,

mivel ezek mind a felületi feszültséget, mind a felületi diffuziós állandót megváltoztatják.

A szinterelés második szakaszában a felületi diffúzió a pórusok egyensúlyi formájának kialakításában játszik szerepet (legömbölyödés).

### AKTIVÁLT SZINTERELÉS

Mivel az aktivált szinterelés az eddig tárgyalt szintereléstől minőségileg különböző folyamat, nem lehet célnak ennek a bonyolult és még távolról sem jól felderített kérdésnek a részletes elemzése. Az alábbi rövid áttekintésnek inkább az a célja, hogy az aktiválás fogalmát tisztázza és a kísérleti munka helyes leírásához segítséget adjon.

Az aktiválás alatt a szinterelésben azt a jelenséget szokás érteni, hogy a szinterelés sebessége valamilyen okból megváltozik. Ez azonban távolról sem nevezhető helyes meghatározásnak. Helyesebben értelmezve a kérdést akkor beszélhetünk aktiválásról, ha a változás valamilyen szilárd, vagy gáznemű adalék anyag hatására jön létre, melyet a szinterelés előtt, vagy alatt juttatunk a mintába. Ahhoz tehát, hogy az aktivációt megállapíthatassuk, az kell, hogy valamilyen folyamatot "közönséges" szinterelésnek fogadhassunk el és ehhez vizsgányítva vizsgálható az adott folyamat. Viszont ahhoz, hogy ezt a "szabvány" szinterelést megadhassuk, az szükséges, hogy áttekinthesük, mi változtatja meg a szinterelés sebességét. mindenek előtt állapodjuk meg abban, hogy a szinterelés mértékéül valamilyen méretváltozás nagyságát vesszük és, hogy a szinterelést az abszolút olvadáspont 90%-át jelentő hőmérsékleten végezzük. Mi okozhat tehát változást?

1. A szinterelés mértékét megváltoztathatja a szemcsék mérete, formája, elrendeződése.
2. A domináló mechanizmus fajtája.
3. A szinterelés hőmérséklete elérésének módja.
4. A porok szinterelés előtti sürűsége és előélete.
5. A szinterelés atmoszférája.

Tehát, hogy a szabvány folyamatunk megbízható legyen a következőkben kell megállapodnunk:

1. A szabvány folyamatot azonos előéletű és méreteloszlású, ismert sürűségű porokkal végezzük (ez utóbbi elegendő, mivel a forma okozta változást korrigálhatjuk).
2. A szabvány szinterelést valamilyen nemes gáz jelenlétében végezzük.
3. Megadjuk a szinterelési hőmérséklet elérésnek módját.
4. Ugy választjuk ki a kísérletet, hogy valamely mechanizmus domináns legyen.

A szinterelés mértékét mint már említettük, valamilyen makroszkopikus változón keresztül mérjük. Ilyen lehet a minta sürűségének változása, vagy a minta lineáris méretváltozása. A munka leirásakor nagy gondot kell fordítani ezen szempontok pontos tisztázására.

A szinterelés aktiválásának jelensége már régóta ismeretes tény. Azonban mindmáig kevéssé tisztázott, hogy a szokástól eltérően lejátszódó szinterelések közül melyikeket nevezhetjük aktiváltnak. Például, ha a volfrám porhoz a platina csoport elemeit adjuk (kivétel az iridium) mint például a nikkel 1-2 % mennyiségen, akkor a sürűség változása rendkívül meggyorsul. Ezt a folyamatot jogosan nevezhetjük aktiválásnak, mivel a nikkel 1400 C° közelében egyenletes rétegben vonja be a volfrám szemcsék felületét és szemcsehatárait és megváltoztatja a felületi tulajdonságokat, valamint a Kirkendall-effektus utján fölös vakanciákat termel, mivel a nikkel jó oldódik és diffundál a volframba, fordítva viszont jelentéktelenek ezek a folyamatok.

Ezzel egy minőségileg új helyzetet teremt, a folyamat meggyorsul, a szinterelés aktivált. Ugyanakkor közismert dolog a volframtechnológiában, hogy a nikkel sók jelenlétében őrült volfrám porok sokkal gyorsabban szinterelhetőek, mint a víz jelenlétében, vagy tisztán őrült volfrám. Vajon ez is aktivált szinterelés? Az első gondolat - éppen a fent leírottak hatására - az lehet, hogy ez aktivált szinterelés. Viszont Quantinetz rájött, hogy a nikkel sók jelenlétében őrült volfram szubmikronos, ultrafinom formáretű és amint azt Hausner ettől függetlenül megállapította, a szubmikronos porok sokkal gyorsabban szinterelhetőek. Mivel a két folyamat paraméterei nagyon jóI egyeznek, azt kell mondanunk, hogy itt szó sem lehet aktivált szinterelésről. Ezt alátámasztja az is, hogy ha az ultrafinom porokhoz nikkel adalékot adunk, további "aktiválást" nem tapasztalunk.

Az aktivált szinterelés másik, jó példája Eudier kísérlete, melyben a vas porok szinterelését irja le ammonium fluorid jelenlétében. Az ammonium fluoridot a hidrogén lékgörében a szinterelés alatti elpárologtatással vitte be a mintába. Ebben az esetben az aktiválást az okozta, hogy a domború felületeken képződött vas fluorid elpárolgott és a homorú részeken lecsapódva elbomlott vasra és fluorra. Ezzel a minőségileg teljesen új folyamattal a vas szinterelése jelentősen aktiválódott. Ha tehát a szinterelés végzésekor és leírásakor kellő pontossággal járunk el, megkülönböztethetjük az aktivált és szokásos szinterelést egymástól.

Miután az aktivált szinterelés fogalmát tisztáztuk, a jelenség tárgyalásával kellene folytatni a munkát. Mivel azonban ez a kérdés rehdkivül |nagy és önálló fejezetét alkotja a szinterelés kérdésének, egy külön munka szükséges ahhoz, hogy kielégítően áttekinthessük. Ezért ezt a munkát a későbbiekben külön közöljük.

Megköszönöm Dr. Bartha Lászlónak a munka folyamán nyújtott állandó segítségét, Dr. Gaál Istyánnak pedig a munka feldolgozása során tett hasznos észrevételeiért mondok köszönetet.

#### IRODALOM

- [1] Frenkel, Ja. I. J. Phys. USSR 9 385 (1945)
- [2] Pines, B. Ja. Zh. Techn. Phys. 16/6 137 (1946)
- [3] Nabarro F.R.N. Rep. of Conf. on Strength of Solids, Phys. Soc. London pp. 75-90 (1948)
- [4] Herring, C. J. Appl. Phys. 21/5 437 (1950)
- [5] Kuczinsky G.C. Trans. AIME 185 169 (1949)
- [6] W. A. Knepper ed. Agglomeration NY 1961
- [7] Lifshitz E.M. Zh. Eksp. i Theor. Phys. 29 94 (1955)
- [8] Weertman J. J. Appl. Phys. 26/10 1213 (1955)
- [9] Koseevich A.M. Zh. Eksp. i. Theor. Phys. 50/4 958 (1966)
- [10] Hingorany A.R., Hirschhorn J.S. Int. Journ. of Powder Met. 2/3 (1966)
- [11] Lifshitz E.M. Zh. Eksp. i. Theor. Phys. 44/4 1349 (1963)
- [12] London F. Z. Physik 63 245 (1930)
- [13] Lifshitz E.M. Phys. Tv. Tela 4/3 1326 (1962)
- [14] Geguzin Ja Je Fizika szpekányija M. 1967 P. 83
- [15] Coble R.L. J. Appr. Phys. 32/5 787 (1961)
- [16] Johnson D.L., Clarke G.M. Acta Met. 12 1173 (1964)
- [17] Johnson D.L. Physics of Sintering 1/3 B (1969)
- [18] Coble R.L. Physics of Sintering 1/3 F (1969)
- [19] Kakar A.K. Journ. Amer. Ceram. Soc. 51/4 236 (1968)

TETRAGONÁLIS K-W-BRONZ ELŐÁLLITÁSA  
ÉS SZERKEZETÉNEK VIZSGÁLATA EGYKRISTÁLY-DIFFRAKTOMÉTERREL<sup>+</sup>

KLUG Annamária

MTA Műszaki Fizikai Kutató Intézet, Budapest

Bronz-vegyületek alatt egy olyan csoportot értünk, melyet  $Me_x RO_3$  általános képlettel írhatunk le, ahol Me alkáli-, alkáli föld-, vagy földfém, R pedig leggyakrabban W, Mo, Nb, Ta, V. A bronz elnevezés e vegyületek színes, fémes fényű megjelenési formájából ered. A fenti általános formula igen népes vegyületcsoportot takar (ld. 1. ábra periódusos rendszere), amely jelenleg is bővül elsősorban a vegyes bronzok sikeres előállitásának következtében.

A legismertebb bronzok tehát a következők:

$Me_x WO_3$
$Me_x MoO_3$
$Me_x NbO_3$
$Me_x TaO_3$
$Me_x VO_3$

Bronzképzőként tartják számon a vasat is, ez esetben azonban az oxigént fluor helyettesíti, amelynek erősebb elektronegativitása miatt az ilyen bronz elektromosan szigetelő lesz, szemben a többiek fémes-, ionos-, vagy félvezető jellegével.

A W-bronzok régóta ismert, kémiai hatásoknak ellenálló vegyületek. Az első W-bronzot 1824-ben állította elő Wöhler. Eljárása során, amelyet ma is alkalmaznak, alkáli

<sup>+</sup>Diplomamunka, készült a Stockholms Universitet Szervetlen- és Fizikai Kémia Tanszékén

fém paravolframátját hevitik száraz  $H_2$  áramban. A W vegyérteke a keletkezett bronzban a hevítési hőmérséklettől és időtől függ. További eljárások is ismertek:

- 1.) paravolframát olvadékok elektrolizise
- 2.)  $Me_2WO_4 + WO_3 + W$  elegye vákuumban hevitve
- 3.)  $Me_2WO_4 + WO_2 + W$  " " "
- 4.)  $Me_2WO_4 + WO_3 + WO_2$  " " "
- 5.)  $MeCO_3 + WO_3$  olvadék elektrolizise
- 6.)  $Me_2WO_4 + WO_3 + W$  tartalmú rendszerben hőmérsékletgradiens hatására lezajló transzportreakció.

A fenti reakciók valamelyikével nyert W-bronzok fémes fényük, színük az alacsony alkáli tartalomnál jellemző sötétkék-ibolyától folyamatosan világosodik, ahogy az arany-sárga színű  $MeWO_3$  összetételhez közeledik. A szint az alkáli atom fajtája lényegesen nem befolyásolja.

A kristályokat sem lugos, sem savas oldatok nem támadják meg s forró királyviz is csak kevéssé oldja. Termikusan stabilak. Kén, alkáli és perszulfát tartalmú olvadékok megtámadják.

A W-bronzok képződését ugy képzelhetjük el, hogy a  $WO_3$  rácsba alkáli ionokat juttatunk be. Ezek ugy épülnek be, hogy a  $WO_3$  rácsot stabilizálják s ennek nyomán az alkáli tartalomtól függően különböző szerkezeteket hoznak létre. Egy-egy szerkezeti típuson belül az alkáli tartalom csökkenésével együtt csökken a rácsparaméter is.

#### 1.) KÖBÖS RÁCS, PEROVSZKIT TÍPUS

jellemzője: szilárd oldat típus, alkáli defektus. Az alkáli atom bevitelével a  $WO_3$  rács összehuzódik elektrosztatikai kölcsönhatás miatt, ugyanakkor a W-O kötés gyengül, ez pedig a rács kiterjedéséhez vezet. A rácsméretet a domináló folyamat szabja meg.

<i>La</i>	<i>Ce</i>	<i>Pr</i>	<i>Nd</i>	<i>Pm</i>	<i>Sm</i>	<i>Eu</i>	<i>Gd</i>	<i>Tb</i>	<i>Dy</i>	<i>Ho</i>	<i>Er</i>	<i>Tm</i>	<i>Yb</i>	<i>Lu</i>
<i>Ac</i>	<i>Th</i>	<i>Pa</i>	<i>U</i>	<i>Np</i>	<i>Pu</i>	<i>Am</i>	<i>Cm</i>	<i>Bk</i>	<i>Cf</i>	<i>Em</i>	<i>Fm</i>	<i>Md</i>	<i>No</i>	<i>Lw</i>

## l. ábra

## Az elemek periodusos rendszere

A Na igen széles határok között:  $1 > x > 0,32$  képez köbös rácsu, nagyon stabil bronzot. ( $x > 0,5$  összetételű, elektrolizissel nyert Na-bronzok ikerstrukturájuak és kettőstörök. A képződési hőmérséklet függ a Na-tartalomtól.) A Li a  $0,57 > x > 0,30$  tartományban képez perovszkit tipusu bronzot, amely kevésbé stabil. Ez mutatkozik abban a tényben, hogy a Li helyettesítheti a Na-t bronzban, de fordítva nem.

Tiszta köbös K-bronz nincs, de vegyes K-Na bronz perovszkit rácsában a K helyettesítheti a Na-t. Fordítva ez sem lehetséges. A W-bronzok H-analógiái is ismertek. de a köbös változat csak  $x \geq 0,50$ -nél jelenik meg, mert a H stabilizáló hatása a  $W_3$  rácsra jóval kisebb, mint az alkáli ionoké.

## 2.) TETRAGONÁLIS I. RÁCSTIPUS

Ez a rácstípus tulajdonképpen átmenet a köbös és az "igazi" tetragonális között. A  $W_6$  oktaéderek deformálódnak, de elrendezésük nem változik. A deformáció azt jelenti, hogy az egyes W atomok nem pontosan a  $0\ 0\ 1/2$  síkban helyezkednek el, hanem kissé alatta, vagy fölött - ami hullámoss felszint és a c tengely megnyulását okozza.

Ilyen bronzokat a Li ( $x=0,30$ ) és a Na ( $x=0,10$ ) képez.

Ha ez a szimmetriacsökkenés előállt és a  $W_3$  rácsba a Li-, illetve Na-nál nagyobb ionok épülnek be, akkor ezek szétrombolják az oktaéderek szabályos elrendeződését és tetragonális vagy hexagonális W-bronzok keletkeznek.

## 3.) TETRAGONÁLIS II. RÁCSTIPUS

Az alkáli tartalom jóval kisebb, mint a köbös bronzokban. Sokszor különböző bronzok heterogén keverékei keletkeznek. A K-bronzok közül a legstabilabb és legjellemzőbb

módosulat a tetragonális II. minden W atom egy síkban van ( $z=1/2$ ) és minden K atom is ( $z=0$ ). Az oktaéderek csak csúcsainon érintkeznek és gyűrükkel (3-, 4-, 5-tagú) alkotnak. Az elemi cellában legfeljebb 6 K atom fér el, tehát  $x_{\max} = 0,60$ . A négyes gyűrükben lévő 2 K atom pedig elég könnyen eltávolítható, tehát  $K_{0,40}W_3$  is elképzelhető. A Na nagyon kis koncentrációval képez tetragonális bronzot, stabilitási intervalluma  $0,38 > x > 0,28$ . Szerkezete hasonló a K-bronzéhoz, azonban a W atomok  $z=1/2-től$  pozitív és negativ irányban is elternek, ezáltal a tetragonális I.-hez hasonló hullámoss felületet képezve. Természetesen a K-nál kisebb alkáli ionok is szabadabban mozoghatnak a gyűrükben. Az ilyen "eltérő" helyzetű reflexekből számított  $a' = a\sqrt{2}$  és  $c' = 2c$  a valódi rácsállandók.

A vegyes K-Na-bronznak is igen széles stabilitási területe van ebben a fázisban, így a perovszkitfázissal ellenértében itt a  $K_xW_3$  és a  $Na_xW_3$  kölcsönös oldhatóságáról beszélhetünk.

#### 4.) HEXAGONÁLIS RÁCSTIPUS

A Cs és a Rb ionjai oly nagyok, hogy a tetragonális rács négyes és ötös gyűrűi szükek számukra. Ezért ezek hexagonális strukturát képeznek: 6  $W_6$  oktaéder alkot egy gyűrűt. A gyűrű átmérője  $3,28 \text{ \AA}$ , tehát igen kevés Cs jut csak be ( $d=3,38 \text{ \AA}$ ).

A K is képez hexagonális bronzot  $0,31 > x > 0,27$  tartományban.

A többi ionra nézve is csak egy szűk x-tartomány érvényes, mivel  $x_{\max} = 2/6 = 0,33$  (6 W atomra jut 2 alkáli).

Létezik vegyes hexagonális bronz is (Na-K, K-Li), de ilyenkor van betöltetlen hely is:  $x + y \approx 0,20$ .

Előállítottak már üres rácsozatot is ( $WO_3$ ), ahol szintén képződtek gyűrük az oktaéderekből. Ha tehát az előzőek alapján azt lehetne gondolni, hogy az alkáli komponens szabja meg a bronz szerkezetét, ugy ez a tény ellentmond e felfogásnak. Valójában még nem ismeretes, hogy pontosan mitől függ a szerkezet.

A bronzok felhasználhatóságát illetően a következő tulajdonságok mérvadók:

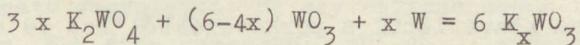
- A változó vegyérték és a rácsdefektus katalitikus hatást eredményez egyes folyamatoknál.
- Jó kémiai ellenállóképességük miatt savas közegű redukcióknál megfelelő elektródanyagok.
- A tetragonális és hexagonális rácsban anizotrop elektromos tulajdonságok, [001] kitüntetett irány.
- Alacsony hőmérsékleten ( $2-7^{\circ}\text{K}$ ) sok szupravezető van köztük (ld. l. ábra) - de nem a perovszkit fázisban.

x x x

A munka célja az volt, hogy a tetragonális  $K_x WO_3$  két évtizeddel ezelőtt megismert szerkezetét a ma rendelkezésre álló legmodernebb eszközök segítségével - automata diffraktométer, számítógéptechnika - még pontosabb adatokkal egészíthessük ki.

## ELÖÁLLITÁS

A vizsgálat céljára szolgáló vegyületet a következő egyenlet szerint állítottuk elő:



ahol  $x=0,6$  illetve  $0,7$ .

A reakció csak meghatározott hőmérsékleti viszonyok mellett eredményezi a várt tiszta terméket. Ennek felderítésére több kísérletet végeztünk.

1.) A finoman elporított keveréket kvarcampullába vittük, leszivattuk és leforrasztottuk, majd 15-20 percig  $930^{\circ}C$ -on hevitettük. A reakció termékeként kemény rög keletkezett, amely mikroszkop alatt vizsgálva hexagonálisnak tűnő, apró, sötétkék kristályokból állt. A mintáról készült Guinier-kamrás porfelvételek több fázis jelenlétét bizonyították.

2.) A kvarccsőbe zárt porkeveréket különböző sebességgel hevitettük fel  $900-980^{\circ}C$  közötti hőmérsékletre s a hőkezelés idejét 10 perc - 24 óra között változtattuk. Az eljárás ugyancsak nem vezetett kellő tisztaságu és méretű tetragonális kristályokhoz.

3.) A porkeveréket aranycsövecskében hevitettük a fenti módon, hogy a kvarc esetleges zavaró hatását kiküszöböljük. Az eredmény így sem volt kielégítő.

4.) Az 1.) alatt leírt eljárással nyert rögöt forró, 2:1 higitásu sósav oldattal kezelve, az apró kristálykákra esik szét, amelyek között számos vöröses színű, tetragonális kristályka is van. A kristályokat megmosva és kiszáritva aranycsőbe töltöttük és a külső kvarcampullával együtt evakuáltuk. Az így előkészített próbát előre felhevített  $-900^{\circ}C$ -kemencébe tettük és 2-4 órai állás után hagytuk lassan kihűlni a kikapcsolt kemencében. Ezzel a módszerrel sikeresít majdnem teljesen tiszta tetragonális fázist

előállitani. A termék hosszu, tü alaku, vöröses-ibolya és ibolyaszínű kristályokból áll.

**Megjegyzés:** A későbbiekben sikerült tetragonális fázis előállítása közvetlenül a porkeverékből is, de csak a kvarccső kizárásával.

#### PORFELVÉTELEK

Minden mintáról Guinier kamrás porfelvételt készítetünk. A legtisztább tetragonális próbák (1. 2. ábra) adatait IBM-1800 gépen dolgoztuk fel. A LAZY program segítségével a porfelvétel vonalainak megfelelő  $\sin^2\theta$  értékeket számítja ki, ezekből pedig a PIRUM program megindíteli a reflexeket és végül kiszámítja az elemi cellaadatát:

$$\begin{aligned} a &= b = 12,2605 \pm 0,0007 \text{ Å} \\ c &= 3,8259 \pm 0,0003 \text{ Å} \\ \alpha &= \beta = \gamma = 90,00^\circ \pm 0,00^\circ \end{aligned}$$



2. ábra

A két legtisztább minta porfelvetele

## KÉMIAI ANALIZIS

A porfelvétellekkel párhuzamosan hozzávetőleges kémiai analizist végeztünk. Az első lépés a próba átalakítása vizben oldható vegyiletté. Ez egy csőkemencében történik, 520°C-on, 6-8 órán keresztül, HCl és O<sub>2</sub> gázáramban. A préparátumtartóban KCl marad vissza (egyenértékű a bronz K-tartalmával) a többi komponens volfram-oxiklorid gázok formájában tévozik. A tulajdonképpeni analízis a KCl megtitralása AgNO<sub>3</sub>-mal (Mohr-féle módszer).

Az eredmények elég pontatlanok (ehhez feltehetően a minta előzetes HCl-ben való mosása is hozzájárul) és nagy szórást mutatnak:

$$K_{0,39}W_3, \quad K_{0,58}W_3, \quad K_{0,59}W_3 \dots, \quad \text{sőt } K_{0,80}W_3.$$

## ADATGYÜJTÉS

A diffraktométeres vizsgálathoz egy jól fejlett kristályt választottunk, melynek mérete 14,4 x 14,6 x 128 μ volt. Ezt leghosszabb élével a goniométer tengelyének irányába állítottuk. Weissenberg felvételről látható volt, hogy ez az irány megfelel a c\* tengelynek. Ezután a kristályt centráltuk, majd beállítottuk a diffraktométeren. A Brägg egyenlet ( $2dsin\theta = n\lambda$ ) segítségével kiszámítottuk néhány erős 001 illetve 0k0 reflex θ értékét és e körül beállítottuk a valódi értéket fél-intenzitás méréssel. Igy a kristály mind önmagában, mind a sugár utjában centrálva van.

	Reflex	$\theta_{calc}$	$\theta_{obs}$	Intens. [imp/ $4 \cdot 10^{-4}$ min]
<u>1. táblázat</u>	001	5.310°	5.348°	33 000
Tesztreflexek a kristály beállításához	002	10.67°	10.706°	21 740
	003	16.18°	16.191°	5 370
	004	21.74°	21.765°	2 240
	006	33.76°	33.800°	773
	008	47.84°	47.870°	246
	040	6.63°	6.64°	2 120
	080	13.42°	13.39°	1 415
	0140	23.85°	23.889°	1 550

A vizsgálat 4 íves ( $\theta$ ,  $2\theta$ ,  $\varphi$ ,  $\chi$ ) Siemens automata diffraktométeren történt Mo-sugárzás és 5-értékű technika alkalmazásával. Ez azt jelenti, hogy minden egyes reflexre 5 intenzitásértéket regisztrál a berendezés: a maximumot, e  $\theta$  értéktől pozitív és negativ irányban  $\Delta\theta_1$  és  $\Delta\theta_2$  tartományban az integrált intenzitást és a reflexcsucs két oldalán a hátteret. A letapogatási területek a következők voltak:

$$\begin{aligned}\Delta\theta_1 &= 0,29 + 0,67 \operatorname{tg} \theta \\ \Delta\theta_2 &= 0,38 + 0,67 \operatorname{tg} \theta.\end{aligned}$$

(A monokromatizálás nem egészen tökéletes volta miatt a reflex nem teljesen szimmetrikus, ezért kell a csökkenő  $\theta$  irányban nagyobb  $k_1$ -t választani.)

A berendezés  $\theta - 2\theta$  scan módszerrel működik, tehát nem csak a reciprok rács pontjai mozognak, áthaladva a reflexiós szférán, hanem egyidejűleg a detektor is elmozdul egy olyan irányban, mely pontosan megfelel a rec. rácspont által megtett távolságának. A diffraktométer az egyes tesztreflexek beállításánál kézzel, vagy félautomatikusan irányítható, ezután azonban vezérlő program készül, neve SIP (IBM 360/75 jelű computerre). Alkalmazásához szükséges adatok: az adott hullámhossz, a kristály szimmetriája,

illetve ebből a reflexiós szféra vizsgálandó hánnya, az elemi cella méreté és a  $\Delta\theta_1$  illetve  $\Delta\theta_2$  értékek. A lyukszalagról teljesen automatikusan történik a beállítás és a mérés. A programtól független azonban a szűrő (jelen esetben csak  $\beta$ -filtort alkalmaztunk) és a mérési alapidő beállítása, ezért ezeket a program megindítása előtt kell elvégezni.

A lehetséges mérési alapidők ( $T$ ):

0,06 0,12 0,24 0,6 1,2 2,4 6 12 24 sec

amelyeknek 1-, 10-, 100- és 1000-szerese is beállítható a mérési időfaktorral ( $F$ ).

A kristály egy oktánsát vizsgáltuk (0,00-0,34  $\sin\theta$  tartomány), ebbe kb. 1100 reflex tartozott, ezért 1,2 sec alapidőt választottunk. Egy észlelés ideje tehát  $\delta T = 1,2 \times 1$  sec volt. Az 5-értékű mérés egyes lépései a következő időt igényelték:

$$t_3 = \delta T (\Delta\theta_1 + \Delta\theta_2) = t_2 = t_4 \quad (t_2 \text{ és } t_4 \text{ a háttér mérése, ilyenkor mozdulatlan a kristály})$$

$$t_1 = \delta T \cdot \Delta\theta_1$$

$$t_2 = \delta T \cdot \Delta\theta_2$$

Egy reflex teljes mérési ideje:

$$T_m = 4 (\Delta\theta_1 + \Delta\theta_2) \delta T + 5t_p \quad \text{ahol } t_p \text{ az eredmény kinyomtatásához szükséges idő}$$

A vezérlőprogramon ugyan szerepel minden 25. reflex után automatikus nullpont ellenőrzés, de a kristály centráltságát és a tesztreflexeket másod- vagy harmadnaponként meg kell vizsgálni.

Az eredmény regisztrálása szintén automatikusan lyukszalagon történt. Ezt később az intézeti 1800-as IBM átmásolta kártyákra ( minden kártya egy-egy reflex indexét és az öt intenzitásértéket tartalmazta).

### A REFLEXANYAG FELDOLGOZÁSA

#### 1. Abszorpciós korrekció

A nyert reflexanyag feldolgozása a DATAP programmal kezdődik, mely abszorpciós korrekciót végez, Lorenz és polarizációs faktort számol, majd ezekből megadja a strukturfaktort és annak standard deviációját.

$$F_{hkl} = \sqrt{\frac{k \cdot I_{hkl}}{L \cdot p}}; \quad L = \frac{\sin \theta}{\sin 2\theta \sqrt{\sin^2 \theta - \sin^2 \mu}}; \\ p = \frac{1 + \cos^2 2\theta}{2}$$

A bemenő adatok között szerepel a vizsgált anyag lineáris abszorpciós koefficiense ( $\mu = \sum \frac{P_i \mu_m}{100}$ ), az elemi cella mérete és a kristály orientációjának leirása. A kristály 6 határsikkal rendelkezik.  $\mu$  értéke  $532,29 \text{ cm}^{-1}$ -nek adódik azzal a feltételezéssel, hogy a kristály összetétele  $K_{0,59} W_{0,3}$  (mólsuly 254,92). Mivel a későbbiekben a LINUS számítások alacsonyabb K-tartalmat mutattak, mely más mólsulyt jelent, ezért az abszorpciós koefficienst az uj  $K_{0,3788} W_{0,3}$  formula alapján átszámítottuk. Ekkor  $\mu = 535,87$ -nel adódott, ami lényegtelen eltérés az eredetitől, tehát nem indokol egy újabb abszorpciós korrekciót.

Ezt a számítást már a központi IBM 360/75 computer végezte. A kapott strukturfaktor eredménylista teljes egészében a következő program bemenő adatait képezi.

## 2. A paraméterek finomítása legkisebb négyzetek módszerével

A következő lépés a LALS nevű program alkalmazása, mely strukturfaktort számol (max. 500 atomra) és finomítja a paramétereket (max. 200-t).

$$\begin{aligned} \text{A strukturfaktor-számítás alapja a következő egyenlet:} \\ |F_{hkl}| &= \sqrt{\left[ \sum_j f_j \cos 2\pi \varphi_j \right]^2 + \left[ \sum_j f_j \sin 2\pi \varphi_j \right]^2} \\ \varphi_j &= hx_j + ky_j + lz_j \end{aligned}$$

Ebben a felfogásban tehát a strukturfaktor azon j hullám eredője, melyeket az egységcella j atomja szór a hkl reflex irányába.

A  $2\pi(hx_j + ky_j + lz_j)$  kifejezés a hullámok közti fáziskülönbség,  $f_j$  pedig az atomok szórási faktora. Utóbbi értékek az Acta Crystallographica 17. illetve 18. kötetéből származnak. Az említett DATAP programból származó  $F_{obs}$  értékeken kívül a bemenő adatok között szerepel az egységcella leírása, az International Tables szerinti ekvivalens pozíciók, a használt sugárzás hullámhossza és a finomítandó paraméterek: az atomi koordináták, hőmérsékleti faktor ( $B=8\pi^2 u^2$ ), szorzófaktor, skálafaktor, mely alapján  $F_{obs}$  és  $F_{calc}$  közös nivón hasonlítható össze.  $/|F_{obs}| = k |F_{calc}| /$ . Erre azért van szükség, mert a strukturfaktor-számítás nem veszi figyelembe a konkrét kristályszerkezetet, hanem statisztikus eloszlást feltételez és figyelmen kívül hagyja a hőmozgást is ( $f=f_0 e^{-B \sin^2 \theta / \lambda^2}$ ).

A paraméterek finomítása legkisebb négyzetek módszerével történik. A legjobb paraméterérték akkor adódik, ha a

$$D = \sum_{hkl} w_{hkl} / |F_o| - |kF_c| / ^2 \text{ kifejezés értéke minimális.}$$

Itt  $k$  = skálafaktor,  $w$  = súlyszám, melynek helyes használata rendkívül fontos az eredmény szempontjából. Legjobb az

eredmény, ha  $w = \frac{1}{\sigma_{F_o}^2}$ ; jelen számításnál Hughes formuláját alkalmaztuk, ahol  $\sigma_{F_o} = F_o$  ha  $F_o > 4 F_o \text{ min}$  és  $\sigma_{F_o} = 4 F_o \text{ min}$  ha  $F_o < 4 F_o \text{ min}$ . Azért alkalmas ez a formula, mert  $F_o$  minimumot változtatva különbözõ sulyanaliziseket kapunk, melyekbõl csak ki kell választani a legjobbat.

A D érték minimizálására a kifejezést egyik változó szerint deriválni kell és nullával egyenlővé tenni. E célból valamennyi finomitandó paramétert változónak tekintjük és sorban mindenylegik szerint deriválunk. (Mivel a strukturfaktor kifejezése nem lineáris, ezért előbb Taylor sorba kell fejteni és így közelíteni:

$$|kF_c/p_1 \dots p_n| = |kF_c/a_1 \dots a_n| + \frac{\partial |kF_c|}{\partial p_1} \Delta p_1 + \dots + \frac{\partial |kF_c|}{\partial p_n} \Delta p_n$$

de az egynél magasabb fokú  $p_j$  tagok elhanyagolhatók.) Igy n paraméter esetén n db egyenletet (u.n. normálegyenleteket) kapunk, melyek megoldása szolgáltatja az új páramétereket. Ezek aztán a következő ciklusban mint változók kerülnek ismét felhasználásra stb. Egy program általában 3-5 ciklusból áll.

Az egyenletrendszer a programban n db mátrixegyenletté alakul ( minden normálegyenlet mátrixa egy sor négyzetes kifejezés lesz). A paraméterek korrelációjától függõen felhasználható a számításban az összes mátrixelem vagy csak a fõátlõmenti blokkok. Meg szokás adni az egyes paraméterek korrelációját konkrétan is, ekkor csak az egyiket finomitja a program, a másik könnyen előállítható a fennálló összefüggés alapján.

Kiindulási paramétereikként A. Magneli<sup>1.)</sup> Weissenberg felvételek alapján kapott értékei szolgáltak:

<sup>1.)</sup>The crystal structure of tetragonal potassium tungsten bronze. Arkiv för Kemi (1947) Band 1 Nr. 24.

2 W-1	(c)	0 1/2 1/2	
8 W-2	(j)	x y 1/2	x=0,078 y=0,209
2 K-1	(a)	0 0 0	
4 K-2	(g)	x 1/2 x 0	x=0,175
2 O-1	(d)	0 1/2 0	
8 O-2	(i)	x y 0	x=0,075 y=0,215
4 O-3	(h)	x 1/2 x 1/2	x=0,30
8 O-4	(j)	x y 1/2	x=0 y=0,345
8 O-5	(j)	x y 1/2	x=0,15 y=0,07

2. táblázat

#### A kiindulási paraméterek

Kezdetben izotrop hőmérsékleti faktorokat és egy általános skálafaktort ( $k=5$ ) használtunk.

Eredmény: az első 5 ciklus alatt a paraméterek zöme nem sokat változott, miközben az R-érték ( $= \frac{\sum |\Delta F|}{\sum |F|}$  minden kisebb ez az érték, annál biztosabb, hogy a használt modell helyes) 4,4%-ra csökkent; DE a 2(a) helyzetű K atom hőmérsékleti faktora majdnem 20,0-ig emelkedett és a 4(g) helyzetű K atom is viszonylag magas hőmérsékleti függést mutatott ( $B=1,0$ ). Az egész ugy hatott, mintha a K atomok helyzetére nézve a modell rossz volna. Ezért szükségessé vált az elektronsürűségi eloszlás kiszámítása az elemi cellára.

#### 3. Fourier differenciál-szintézis

Mivel a K atomok helyzete érdekel, elegendő a 000 helyzetre vonatkozó Fourier differenciál-szintézis. Ezt a DRF

nevű program számítja ki a strukturfaktor exponenciális formájából:

$$F = \sum_j f_j e^{2\pi i/hx_j + ky_j + lz_j}$$

A kifejezés átalakítható, ha figyelembe vesszük a szórási faktor valódi jelentését:

$$f = g dv \text{ ahol } g \text{ az elektronsürűség,}$$

Mivel a térfogategységben lévő elektronok száma  $g/x, y, z/dv$ , a sugárzást tehát  $g/x, y, z/ e^{-2\pi i/hx+ky+lz}/dv$  szórja. Ha ezt az egységcella egész térfogatára integráljuk, akkor a strukturfaktor alábbi formája nyerhető:

$$F = \int_V g/x, y, z/ e^{2\pi i/hx+ky+lz/} dv .$$

Az elektronszerkezet periodikus volta miatt egy kristály elektroneloszlása legjobban egy 3-dimenziós Fourier sorral reprezentálható, amely különböző átalakítások után így irható fel:

$$g/x, y, z/ = \frac{1}{V} \sum_{hkl} F_{hkl} e^{-2\pi i/hx+ky+lz/}$$

A 3 dimenziós Fourier szintézis a cella egyik lapjával párhuzamos rétegekben történik. A "pontok" egy szabályos rácsban - a kristálytani tengelyek mentén - helyezkednek el és a térköz az igények szerint változtatható. Jelen vizsgálatnál ez  $0,01 \text{ \AA}$  volt az "a" illetve "b" tengelyek és  $0,05 \text{ \AA}$  a "c" tengely mentén.

Az eredmény azonban az elektroneloszlás maximumát a 000 pontban mutatta - tehát a K atom jól volt elhelyezve. A további LALS-forgatások viszont változatlan eredményt hoztak.

#### 4. A szorzófaktor mint változó

Ezután került sor egy igen hasonló, LINUS nevű program kipróbálására, amely csak annyiban tér el a LALS-tól, hogy a szorzófaktort is változónak tekinti. E program érdekes eredményt hozott:

már 3 ciklus után a K-1 atom hőmérsékleti faktora elfogadható értéket vett fel, de ezzel egyidejűleg a szorzófaktor eredeti értékének 14,4%-ra csökkent. A K-2 atom szorzófaktora is kisebb lett 8%-kai. További finomítások még 1%-os csökkenést hoztak. (A számítást részben anyagiak, részben idő hiányában nem folytattuk tovább, bár a szorzófaktor értéke még nem stabilizálódott teljesen.)

A kiindulási és az új szorzófaktorok összehasonlitása a 3. táblázatban látható. Ugyanitt leolvasható az is, hogy a kristály átszámított összetétele  $K_{0,3788} WO_3^*$

#### 5. Anizotrop paraméterek finomítása

Ezután visszatértünk a LALS programhoz, de most már anizotrop hőmérsékleti faktorokat használva, majd tekintetbe véve az anomális diszperziót is. Előbb azonban a reflexanyagot mintegy felére csökkentettük egy egyszerű program segítségével, mely megvizsgált minden tükörsík szerint összszetartozó reflexpárt (pl. 404 és 044) és ha  $\Delta F_o$  nem volt nagyobb a megadott értéknél, akkor a kétféle  $F_o$  helyett azok középértéke került csak felhasználásra a későbbiekbén.

atom	szám, helyzet	kezdeti szorzófaktor	új szorzófaktor
W-1	2 (c)	0,25	0,25
W-2	8 (j)	1,0	1,0
K-1	2 (a)	0,25	0,0235
K-2	4 (g)	0,50	0,45
O-1	2 (d)	0,25	0,25
O-2	8 (i)	1,0	1,0
O-3	4 (h)	0,50	0,50
O-4	8 (j)	1,0	1,0
O-5	8 (j)	1,0	1,0
megfelelő összetételei		$K_{0.6}WO_3$	$K_{0.3788}WO_3$

### 3. táblázat

A szorzófaktorok összehasonlítása

A finomításokkal R értékét sikerült 2,07%-ig leszorítani (márpedig 2,5% alatt biztosak lehetünk a szerkezet helyességében), ugyanakkor elég jónak látszott a kapott sulyanalizis is (l. 4. táblázat). Ekkor az atomi helyzetkoordináták az 5. táblázatban látható értékeket vették fel. A 3. táblázat kiindulási értékeivel összevetve a harmadik, sőt helyenként a második tizedes jegyben is történt változás, valamint több értékes jegy pontosságu az eredmény.

sin $\theta$ tartomány	w. $\Delta^2$	reflex szám	$F_{obs}$	tartomány	w. $\Delta^2$	reflex szám
0.0 - 0.2739	0.8527	74	0.0	- 48.9	4.5597	52
0.2739 - 0.3450	0.8858	70	48.9	- 63.6	4.1245	52
0.3450 - 0.3950	1.0490	64	63.6	- 76.8	4.1477	52
0.3950 - 0.4347	0.9786	57	76.8	- 90.4	0.8482	52
0.4347 - 0.4683	0.8108	52	90.4	- 109.5	0.6933	52
0.4683 - 0.4976	0.6032	61	109.5	- 128.2	0.8097	52
0.4976 - 0.5239	0.7852	50	128.2	- 154.3	0.7628	52
0.5239 - 0.5477	1.2744	40	154.3	- 180.4	0.6868	52
0.5477 - 0.5696	2.1061	36	180.4	- 232.9	0.7903	52
0.5696 - 0.5900	4.8053	16	232.9	- 746.5	4.2768	52

### 4. táblázat

A sulyanalizis eredménye

2 W-1	(c)	0 1/2 1/2	
8 W-2	(j)	x y 1/2	x=0,0757 y=0,2070
2 K-1	(a)	0 0 0	
4 K-2	(g)	x 1/2+x 0	x=0,1718
2 O-1	(d)	0 1/2 0	
8 O-2	(i)	x y 0	x=0,0764 y=0,2065
4 O-3	(h)	x 1/2+x 1/2	x=0,2886
8 O-4	(j)	x y 1/2	x=-0,0001 y=0,3453
8 O-5	(j)	x y 1/2	x=0,1432 y=0,0690

### 5. táblázat

#### Az új atomkoordináták

Az anizotrop hőmérsékleti faktorok (6. táblázat) értékeiből látható, hogy az atomok hőmozgása az x és y tengelyek mentén azonos, de egy nagyságrenddel nagyobb a z tengely irányában. (Természetesen a K atomok jóval mozgékonnyabbak a W atomknál.)

Az anomális diszperzió korrigálására irányuló számítás észrevehető változást nem mutatott a paraméterekben.

#### A SZERKEZET ÉRTELMEZÉSE, ATOMKÖZI TÁVOLSÁGOK

Az elemi cella adatai és az atomi helyzetkoordináták felhasználássával a DISTAN nevű program kiszámítja a kötéstávolságokat és szögeket (7. táblázat).

*hőmérsékleti faktorok az anizotrop finomítás után\**

<i>Atom</i>	<i>B11</i>	<i>B22</i>	<i>B33</i>	<i>B12</i>	<i>B13</i>	<i>B23</i>
<i>W-1</i>	<i>0.000445</i>	<i>0.000445</i>	<i>0.006596</i>	<i>0.000244</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>
<i>W-2</i>	<i>0.000513</i>	<i>0.000505</i>	<i>0.003739</i>	<i>0.000128</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>
<i>K-1</i>	<i>0.002867</i>	<i>0.002867</i>	<i>0.009343</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>
<i>K-2</i>	<i>0.001990</i>	<i>0.001990</i>	<i>0.013078</i>	<i>-0.002519</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>
<i>O-1</i>	<i>0.001444</i>	<i>0.001444</i>	<i>0.014840</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>
<i>O-2</i>	<i>0.000919</i>	<i>0.000919</i>	<i>0.009438</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>
<i>O-3</i>	<i>0.000525</i>	<i>0.000525</i>	<i>0.005394</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>
<i>O-4</i>	<i>0.001053</i>	<i>0.001053</i>	<i>0.010790</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>
<i>O-5</i>	<i>0.000787</i>	<i>0.000787</i>	<i>0.008092</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>

6. táblázat

\*Az oxigén atomok anizotrop hőmérsékleti faktorai csupán a finomított izotrop hőmérsékleti faktorokból való átszámítás eredményei

A szerkezet alapját  $W_0$ <sub>6</sub> oktaéderek képezik (l. 3. ábra). Ezekből kétféle létezik. Azok az oktaéderek, melyeknek középpontjában W-1 atom van, felezik az "a" illetve "b" élekét, az egy síkban lévő oxigén atomok pedig szimmetria-ekvivalensek (O-4 típus). Az oktaéder 2 csucsán O-1 atomok vannak, melyeknek a középponti W-1 atomtól való távolsága 1,913 Å. Az O-4 - W-1 távolság 1,897 Å. A 4 db 1/2 cellamagasságban fekvő O-4 atom szabályos négyszöget képez (90,0°-os szög, 2,682 Å távolság).

Az egységcella belséjében 8 oktaéder van, ezek W-2 központi atomjait különböző oxigén atomok koordinálják: 2 db O-5, 1 db O-3 és 1 db O-4 atom fekszik z=1/2 nívón, az oktaéder csucsaiban pedig O-2 atomok találhatók. A különböző oxigénatomok által bezárt szög nem 90°. A W-2 - O-2 távolság megegyezik a másik típusú oktaéder W-1 - O-1 távolságával (1,913 Å), de a W-2 és a 4 különböző oxigénatom közötti távolság mindenkorban eltérő (l. 7. táblázat).

Az oktaéderek sarkaikon érintkeznek egymással a z=1/2 síkban és hármas-, négyes-, illetve ötös gyűrükkel képeznek. Ha ezeket a z tengely mentén nézzük, akkor különböző nagyságú kanálisokat látunk. A hármas gyűrük tul kicsik, ezért ezek üresek. De a négyes gyűrükben, melyeket 4 db W-2 típusú oktaéder alkot, már van hely egy K-1 atom számára (000 illetve 1/2 1/2 0 helyzet), bár igen szükséges. A csettorná átmérője 5,461 Å, miközben a K<sup>+</sup> átmérője valamint a O<sup>2-</sup> sugara együttesen kb. 5,460 Å.

Az O-2 K-1 O-2 szög nagysága 90,0°.

A másik típusú, 4 szimmetriaekvivalens K-2 atomot 5-5 oktaéder veszi körül, ezekből 4 W-2 típusú, 1 pedig W-1 típusú.

Készült egy DISTAN program is, hogy A. Magneli mértékeit helyettesítettük be. Az eredmény (ez is megtekinthető a 7. táblázatban) az egyes atompárokra általában

nagyobb távolságokat mutatott, mint a  $K_{0,3788}W_3$  kristály kötései. A különbség valamivel nagyobb volt a standard deviációnál. Kivételt képzett 3 kötés: W-1 - 0-3

K-1 - 0-2

0-3 - 0-4

Itt a különbség jelentősen nagyobb volt. A későbbiekben ez természetesen azt okozta, hogy a csatornák átmérője (a K-1 atom körül) szintén nagyobb volt az A.Magneli-féle szerkezetben. Ez pedig annak nagyobb K-tartalmával magyarázható.

#### MIKROSZONDA-ANALIZIS

A program által számított szorzófaktorok és a kémiai analízis eredményének összehasonlítása nem alkalmas következtetésekre. Ennek oka, hogy az analízsnél használt minta relativ tisztasága ellenére is több fázist tartalmaz, míg a diffraktométer adatait egyetlen kristályról szerzi. De hozzájárul az analízis módszerének primitivsége is.

Ezért szükséges volt egy megbizható kontroll, mégpedig olyan módszerrel, mely szintén egyes kristályokat vizsgál. Erre igen alkalmas a mikroszonda-analízis.

A vizsgálathoz a kristályokat igen körültekintően kellett megválasztani: egyrészt nem lehetnek  $10 \mu$ -nél kisebbek és lehetőleg jól kifejlett lapokkal rendelkezzenek, másrészről a három preparátumból válogatott kristályok különböző színük legyenek. Tehát egy-egy termékből több mintát kellett venni.

A kristályokat ezüst-araldit masszába ágyaztuk, megzsilárdulás után pedig optikai sikot csiszoltunk a felületre. minden egyes kristályon 5 pontot megvizsgálva adódtak a következő eredmények:

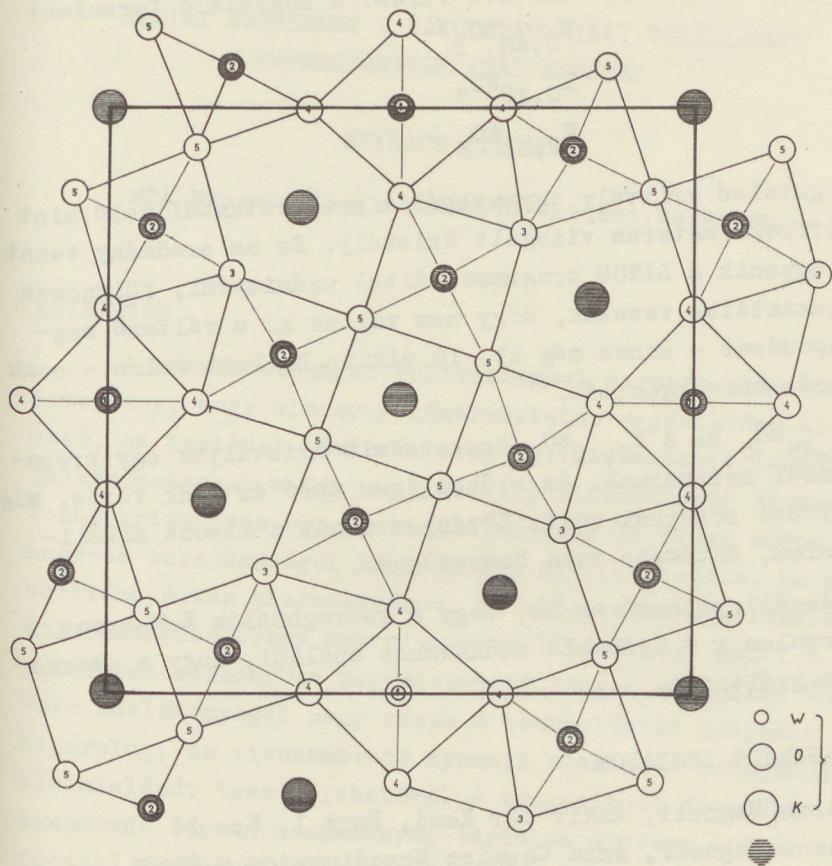
az első próba, mely hexagonális porfelvételt mutatott, 5,1% K-ot tartalmazott, azaz  $K_{0,32}W_3$  összetételnek felel meg.

## 7. Táblázat

Kötéstávolságok

atom1	atom2	dist	sd	dist(AM)
W-1	30-4	1.897	0.007	1.904
	0-4	1.897	0.007	1.904
	20-1	1.913	0.000	1.916
	2K-2	3.541	0.001	3.594
	2K-2	3.541	0.001	3.594
	20-3	3.690	0.009	3.475
	3W-2	3.710	0.001	3.701
	W-2	3.710	0.001	3.701
	2W-1	3.826	0.001	3.833
	0-5	1.884	0.007	1.923
	20-2	1.913	0.000	1.918
	0-4	1.933	0.007	1.926
W-2	0-5	1.938	0.007	1.957
	0-3	1.948	0.007	1.870
	2K-1	3.311	0.000	3.344
	2K-2	3.665	0.001	3.613
	W-1	3.710	0.001	3.701
	0-4	3.722	0.008	3.698
	W-2	3.768	0.001	3.701
	2W-2	3.822	0.001	3.833
	2W-2	3.826	0.001	3.876
	2K-2	3.882	0.002	2.920
	40-2	2.699	0.007	2.797
	80-5	2.731	0.005	2.794
K-1	7W-2	3.311	0.000	3.344
	W-2	3.311	0.000	3.344
	2K-1	3.826	0.001	3.833
	20-3	2.768	0.007	2.896
	40-4	2.852	0.006	2.891
K2	0-1	2.979	0.002	3.040
	20-2	3.116	0.007	3.110
	40-5	3.224	0.006	3.156
	20-2	3.389	0.007	3.335
	2W-1	3.541	0.001	3.594
	4W-2	3.665	0.002	3.613
	2K-2	3.826	0.001	3.833
	4W-2	3.882	0.002	3.920
	2W-1	1.913	0.000	1.916
	70-4	2.694	0.005	2.702
O-1	0-4	2.694	0.005	2.702
	K-2	2.979	0.002	3.040
	K-2	2.979	0.002	3.040
	30-2	3.719	0.007	3.620
	0-2	3.719	0.007	3.620
	20-1	3.826	0.001	3.833
	40-3	-		3.968

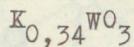
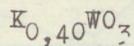
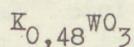
atom1	atom2	dist	sd	dist(AM)
0-2	2W-2	1.913	0.000	1.918
	20-5	2.768	0.007	2.736
	K-1	2.699	0.007	2.797
	20-4	2.727	0.007	2.659
	20-5	2.727	0.007	2.774
	20-3	2.727	0.007	2.669
	K-2	3.116	0.007	3.110
	K-2	3.389	0.007	3.335
	O-1	3.719	0.007	3.620
	O-2	3.765	0.014	3.648
	20-2	3.817	0.10	3.833
	20-2	3.826	0.001	3.956
0-3	2W-2	1.948	0.007	1.870
	20-4	2.706	0.009	2.518
	40-2	2.727	0.007	2.669
	2K-2	2.768	0.007	2.896
	20-5	2.808	0.014	2.892
	W-1	3.690	0.009	3.475
	20-3	3.826	0.001	3.833
	20-4	3.876	0.014	-
	20-5	3.880	0.009	3.794
	20-1	-		3.968
0-4	W-1	1.897	0.007	1.904
	W-2	1.933	0.007	1.926
	O-5	2.618	0.010	2.545
	O-4	2.681	0.015	2.693
	O-4	2.684	0.015	2.693
	20-1	2.694	0.005	2.702
	O-3	2.706	0.009	2.518
	20-2	2.727	0.007	2.659
	2K-2	2.852	0.006	2.891
	W-2	3.722	0.008	3.698
	O-4	3.794	0.014	3.808
	O-5	3.816	0.010	3.848
	20-4	3.826	0.001	3.833
	O-3	3.876	0.014	-
0-5	W-2	1.884	0.007	1.923
	W-2	1.938	0.007	1.957
	O-4	2.618	0.010	2.545
	20-2	2.678	0.007	2.736
	20-2	2.727	0.007	2.774
	2K-1	2.731	0.005	2.794
	20-5	2.756	0.010	2.876
	O-3	2.808	0.014	2.892
	2K-2	3.224	0.006	3.156
	O-4	3.816	0.010	3.848
	20-5	3.826	0.001	3.833
	O-3	3.880	0.009	3.794
	O-5	3.897	0.014	-



3. ábra

A szerkezet vetülete a [001] irányával párhuzamosan

A másik két tetragonális próba a következő K-tartalmakat mutatta: 7,4, 6,3 illetve 5,4%. A megfelelő formulák:



A legutolsó kristály ugyanabból a preparátumból való, mint a diffrakt méteren vizsgált kristály. Ez az eredmény tehát jól egyezik a LINUS programok által számítottal, különösen ha tekintetbe vesszük, hogy nem vártuk ki a változó meghatalmazását - ehhez még kb. 10 ciklus kellett volna - csak az erős konvergenciát.

A  $K_{0,48} WO_3$  és a  $K_{0,40} WO_3$  összetételű kristályok egy preparátumból származnak. Az előbbi igen apró és álenk vörös, míg az utóbbi sötétkék volt. Érvényes tehát a kisebb alkálitartalom, sötétebb szín összefüggés.

Megállapítható az is, hogy a tetragonális K-W-bronz K-tartalma  $x = 0,40$  alá csökkenhet anélkül, hogy a szerkezet megváltozna.

#### FELHASZNÁLT IRODALOM

Arne Magneli, Arkiv för Kemi, Band 1, Nr. 24

Arne Magneli, Acta Chemica Scandinavica 5 (1951)  
372-78

P.G. Dickens - M.S. Whittingham, Quarterly Reviews 1968,  
Vol. XXII, No.1

E.O. Brimm - J.C. Brantley - J.H. Lorenz - M.H. Jellinek,  
J. Am. Chem. Soc. 1951, 73, 5427

P.E. Bierstedt - T.A. Bither - F.J. Darnell, Solid State  
Communications Vol. 4 (1966) 25-26

Georg H. Staut - Lyle H. Jensen, X-ray structure de-  
termination, A practical guide (The  
MacMillan Company, 1968)

J.H. Ingold - R.C. De Vries, Acta Met. 6 (1958), 736-57

M. Atoji - R.E. Rundle, J. Chem. Phys. 32 (1961), 627-8

R.P. Ozerov, Doklady Akad. Nauk SSSR 99 (1954), 93-5

KÉMIAI MODSZEREK A VÁKUUMTECHNIKAI VOLFRÁMFÉM  
NYOMELEMEINEK ANALÍZISÉHEZ

BUXBAUM Piroska

MTA Műszaki Fizikai Kutató Intézet, Budapest

BEVEZETÉS

A vákuumtechnikai volfrámfémmel szemben alapvető követelmény, hogy alacsony hőmérsékleten megfelelően alakítható, az izzitási hőmérsékleten pedig alaktartó legyen. E tulajdonságokat a fém nagykristályos szerkezete biztosítja. A nagykristályos szerkezet kialakítása és ilyen módon a hasznos tulajdonságok biztosítása ugy lehetséges, ha a volfrámgártás alapanyagához, az előzetesen megtisztított volfrámsavhoz (vagy ammoniumparavolfrámáthoz) kb. 1 % mennyiségen célszerűen megválasztott idegen anyagokat adnak. Ezen adalékanyagok nagy része a technológiai folyamat során kipárolog, de visszamaradó nyomaik alaktartó tulajdonságok kialakulását teszik lehetővé. A zsugorított fémrudban visszamaradó összes idegenanyag-tartalom mintegy 0,02%, mely a további megmunkálás során még csökken [1].

Minthogy a nagykristályos szerkezet kialakulása adalékanyagok, például K, Si és Al együttes jelenlétét feltételezi, fontos ezen elemek, valamint a volfrámfémben előforduló egyéb szennyezők mennyiségnak pontos ismerete.

Az elemek egy része tehát mint adalékanyag, a redukció előtt kerül a volfrámxoidhoz. A volfrámgártásban adalékanyagként elsősorban a következő elemeket alkalmazzák: kálium, nátrium, szilicium és aluminium, korábban pedig a vas is. Az elemek másik része – csak a legfontosabbakat

emlitve: a vas, nikkel, molibdén és a szén - vagy az alapanyag szennyezésétől származnak, vagy a technológiai folyamat során szennyeződhet velük a termék. Az elemek - mit szennyezők - koncentrációja, bármilyen eredetük is legyenek,  $10^{-4}\%$ , azaz ppm nagyságrendű.

A volfrámfém analizisére alkalmazott valamennyi módszernél (fizikai, kémiai) igen intenziven jelentkeznek a mátrix anyag nem kivánatos tulajdonságai, melyek bonyolulttá, hosszadalmasá teszik az eljárásokat, ezáltal rontják a ki-mutatási határt és növelik a pontatlanságot. Ez az egyik alapvető oka annak, hogy a kémiai analitikai módszerek ma sem nélkülözhetők a volfrámfém szennyezőinek analizisében, s közvetlen roncsolásmentes nyomszennyező meghatározással csak ritkán találkozunk.

Az 1. táblázatban foglaltam össze a volfrámfém és a volfrámxoxid nyomszennyezőinek analizisére alkalmazott nem kémiai jellegű módszereket. (A teljesség kedvéért az 1. táblázat tartalmazza az irodalomjegyzékben szereplő szerzők által vizsgált valamennyi mátrix anyagot és szennyező elemet.)

1. táblázat

Analitikai módszer	Vizsgált elemek	Kimutathatóság, vizsgált koncentráció tartomány, hiba	Irodalom	
	Ca, Mg, Si, Al, K Li, Na, K, Ti, Cr, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Mn, As, Sb, Bi, Sn, Si, Al, Fe, Ca, Sr, Ba, Cd, In, Mg, B, P	W (fémport) $\frac{Si}{Al} 2 \cdot 10^{-4} - 1 \cdot 10^{-1}$ $Al 5 \cdot 10^{-5} - 1 \cdot 10^{-2} \%$ K $3 \cdot 10^{-3} - 1 \cdot 10^{-1} \%$ Érzékenység: $3 \cdot 10^{-3} - 5 \cdot 10^{-7} \%$ Relatív hiba: 6 - 15 %	[2]	
Spektrográfia	Bi, Sb, Sn, Pb, Cd, Zn, Cu, Mg, Mn, Fe, Al, Co, Ni Fe, Mo, Co, Ni, Mn, Ti	W, WO <sub>3</sub> WO <sub>3</sub>	Meghatározási tartomány: $3 \cdot 10^{-6} - 1 \cdot 10^{-4} \%$ Fe, Mo: $10^{-3} \pm 10\%$ Co, Ni, Mn, Ti; $10^{-4} \pm 10\%$ Érzékenység: Cr, Cu, Co, Ni, Mn, Fe, V; $5 \cdot 10^{-4} \%$	[4]
	56 elem	W	Meghatározási tartomány: $1 \cdot 10^{-5} - 3 \cdot 10^{-4} \%$ Érzékenység: Cr, Cu, Co, Ni, Mn, Fe, V; $5 \cdot 10^{-4} \%$	[5]
Röntgen spektrográfia	V, Fe, Co, Mn, Cu, Ni, Cr Al, Ca, Cr, Co, Fe, Mg, Cu, Ni, Mn, Ti, Zn	WO <sub>3</sub> W	Érzékenység: Cu, Ni, Mn/1-20/.10 <sup>-4</sup> % $\pm 10\%$ Meghatározási tartomány: Cu, Ni, Mn/1-20/.10 <sup>-4</sup> % $\pm 10\%$ Kimutatási határ: 0,05 - 0,14 µg	[6]
Röntgen fluorescencia	Al, Si, P, S, Cl, K, Ca, Ti, V, Cr, Fe, Mn, Co, Ni, Cu, Zn	W	Kimutathatóság alsó határa: Al 5 %, Si 5% K 3 %, Fe 0,5 %, Ni, Cu, Zn 0,1% Érzékenység: 2 · 10 <sup>-5</sup> - 1 · 10 <sup>-4</sup> % Pontosság: 10 % (0 - 4 · 10 <sup>-3</sup> % esetén)	[21]
Elektronugarsas mikroanalizis	C	W, B, Ti, V, Cr, Zr, Nb, Mo	Kimutatási határ: 0,1 % C [25]	[22]

Analitikai módszer	Vizsgált elemek	Mátrix anyag	Klimatiztatóság, vizsgált koncentráció tartomány, hiba	Irodalom
Cu, As, Mo, Zr, Cr, <u>Nb</u> , Fe, Sn	W	O, l g-ban meghatározható: Fe $6 \cdot 10^{-1}\%$ ; Mo $2 \cdot 10^{-3}\%$ Nb $1,2 \cdot 10^{-3}\%$ ; K $9 \cdot 10^{-3}\%$	[8]	
Mo	W	Klimatizzási határ: $10^{-8}$ g Mo	[9]	
B, C, N, O, F	W, Mo, Nb, Ta	Írzékenység: $< 5 \cdot 10^{-5}\%$	[10]	
K, Na	W, Mo	0,1 g-ból Na $\geq 5 \cdot 10^{-9}\%$ K $\geq 5 \cdot 10^{-8}\%$	[11]	
Mo, Si, Mn, Ni, Ba, Ta, W	W, Mo, grafit		[12]	
P, Co, Cr, Fe, Zr, Hf, Ta, Th	W, Mo	Klimatizási határ: $1 \cdot 10^{-6} - 5 \cdot 10^{-5}\%$ Mo, Zr $1 \cdot 10^{-5}\%$	[13]	
K, Na	W	Meghatározási tartomány: $\frac{Na}{K} (2 \cdot 17) \cdot \frac{10^{-4}}{(4 \cdot 5 \cdot 7)} \cdot \frac{10^{-3}}{10^{-3}\%}$	[14]	
Na, K, Ca	W	Meghatározási tartomány: Na $10^{-2} - 10^{-5}\%$ ; K $10^{-2} - 10^{-4}\%$	[15]	
K	W, Mo		[16]	
Na	W, Nb, Ta		[17]	
Cu	W, Ti, Zr, Hf, Nb, Ta	Meghatározási tartomány: $(1 \cdot 10) \cdot 10^{-3}\%$	[18]	
Atomabszorpció spektrofotometria	Co, Zn	Meghatározási tartomány: $5 \cdot 10^{-4} - 5 \cdot 10^{-2}\%$	[19]	
Laser-mikrospektroanalízis	60 elem	Klimatizási határ: $< 10^{-6}$ g	[25]	
Tömegspektrometria	H, O, N, O, 22 fém	Klasszikus tömegspektrometria $10^{-7} - 10^{-9}\%$ érzékenysége:	[24]	

A továbbiakban olyan kémiai módszereket ismertetek, melyeket eredményesen alkalmaztak volfrámfémben ppm nagyságrendben előforduló néhány fontosabb elem meghatározására.

Egyes meghatározásokkal kapcsolatban kissé részletesebben térek ki néhány olyan kérdésre, melyet maguk a szerzők irnak le, vagy melyek megemlítését saját tapasztalataim alapján fontosnak tartom.

Az ismertetésre kerülő kémiai módszerek közös jellemzője, hogy a kérdéses komponensek a vizsgálandó próbában lévő összes mennyiséget mérik, bármilyen formában, helyzetben vannak is jelen a fémben.

#### Aluminum

Vákuumtechnikai volfrámfémben lévő Al meghatározására minden esetben elválasztás utáni fotometriás mérést alkalmaznak.

A 2. táblázatban foglaltam össze a meghatározásokra jellemző adatokat.

2. táblázat

Meghatározási módszer	Vizsgált koncentráció-tartomány, kímutathatóság, hiba	Irodalom
Savas-nikotinos volfrámsav elválasztás - fotometriás mérés	$0-1,5 \cdot 10^{-2} \%$ Al $\pm$ 2-20% (0,1 g W-ban)	[26]
Eriokromcianin-R		
Extraktíós elválasztás	Min. meghatározható: $2 \cdot 10^{-4} \%$ Al	[28]
Fotometriás mérés	$0-20 \mu\text{g}$ Al $\pm$ 20% (0,1 g W-ban)	[30]
Fluorimetriás mérés 8-oxikinolin	$5 \cdot 10^{-4} - 3 \cdot 10^{-3} \%$ Al $\pm$ 4%	[29]
Elválasztás után-fotometriás mérés Arzenazo II	$2 \cdot 10^{-4} - 2 \cdot 10^{-2} \%$ Al $\sim$ 10%	[31]

Millner T. és Neugebauer J. [26] által leírt savas, majd nikotinos volfrámsav lecsapás után végzett fotometriás Eirokrómcianin-R módszernél a fotometriás reakció körülmenyeit módosítottuk újabb irodalmi adatok ismeretében [27]. A vas zavaró hatását aszkorbinsavval szüntettük meg, a reagens oldatot naponta frissen készítettük a [27] szerzők által leírtak alapján. A fotometriás mérést az oldatok elkészülését követő 2-10 percben végeztük. Jól reprodukálható eredményeket kaptunk a 2. táblázatban megjelölt koncentrációtartományban.

Gentry C.H.R. és munkatársai [28] leírják, hogy az aluminium-8-oxikinolin komplex az általuk vizsgált körülmenyek között a 4,5 - 11,5 pH tartományban extrahálható kloroformmal, kivéve a 6,5-8,0 pH-tartományt, ahol extraktiós minimumot mértek ki. Feltehetően az oxinát komplex emlitett extraktiós tulajdonsága miatt Danneil [29] extraktiót végez savas közegben pH = 4,6-on, majd egy másikat az oldat átlugositása után pH = 9,0 értéken. Az eljárás azonban nehézkes és sok bizonytalanságot rejt magában.

### Kálium

Volfrámfémben történő kálium meghatározásra az ezüsttel érzékenyített nátriumkobaltinitrites turbidimetriás eljárás az egyetlen ismert kémiai analitikai módszer [26]. A módszerrel meghatározható:  $2,5-30 \mu\text{g K} \pm 2 \mu\text{g}$  0,1-0,2 g W-ban.

### Szilicium

1. Elválasztás nélkül határoznak meg 0-30  $\mu\text{g}$  ill. 0-100  $\mu\text{g}$  Si-ot 0,1 g W-ban. A szilikomolibdát benzidines redukciójánál keletkező kék színű kolloid oldatot használják fotometriás mérésre [26].

2. R.J. Truman és munkatársa [32] által leírt módszernél a volfrámot segédkomplexképzőkkel tartják oldatban és ezáltal kúszöbölik ki zavaró hatását. A Si mérésére az ismert molibdénkék reakciót alkalmazzák.

A szerzők által végzett Si mérések:

W fém	0,005-0,008 % Si
WO <sub>3</sub>	0,009-0,017 % Si
Ammoniumpara-volframát	0 - 0,007 % Si

3. Az A. S.T.M. [32a] előirása az ismert térfogatos módszert irja le szilicium meghatározására volfrámfémben, melynek lényege a következő: A minta Si tartalmát K<sub>2</sub>SiF<sub>6</sub> formájában választja le, majd a hidroliziskor felszabaduló fluorhidrogénsavat nátronluggal térfogatosan méri.

1.0 ml 0.1 N NaOH 702,3 µg Si-ot mér, ami 1 g mintát bemérve 7.10<sup>-2</sup> % Si-tartalomnak felel meg.

Vas

A 3. táblázat összefoglalja kismennyiségű vas meghatározási módsereit volfrámfémben.

3. táblázat

Meghatározási módszer	Vizsgált koncentráció-tartomány, kimutathatóság, hiba	Irodalom
Savas lecsapás- fotometriás mérés dimetilglixoxim	$0\text{--}1,6 \cdot 10^{-2}\%$ Fe ( $0,1\text{ g}$ W-ban)	[26]
Bathofenantrolin (4,7-difenil-1,10-fenantrolin) extrakció-spektrofotometriás mérés	$5 \cdot 10^{-4} \text{--} 1,5 \cdot 10^{-2}\%$ Fe Hiba: $\pm 5\text{--}10\%$ $10 \cdot 10^{-4} \text{--} 12,5 \cdot 10^{-2}\%$ Fe	[33, 34] [35]
1,10-Fenantrolin extrakció-spektrofotometriás mérés	$(10\text{--}15}) \cdot 10^{-4}\%$ Fe	[36]
Kationcserékromatográfia-spektrofotometriás mérés 1,10-fenantrolin	Érzékenység: $1 \cdot 10^{-4}\%$ Fe	[43]
PAN <sup>(1)</sup> extrakció-spektrofotometriás meghatározás	$10^{-4}\%$ Fe	[37]
Extrakció NaDDTC <sup>(2)</sup> - fotometriás mérés 2,2-dipiridil	$10 \cdot 10^{-4} \text{--} 2 \cdot 10^{-2}\%$ Fe	[38]
Extrakció NaDDTC- fotometriás mérés o-dianizidin, diantipirilmetán	Érzékenység: $5 \cdot 10^{-5}\%$ Fe Addiciós mérés: $5\text{--}25\text{ }\mu\text{g}$ Fe	[39]

(1) PAN- 1-(2-Piridilazo)- 2-naftol

(2) NaDDTC- Nátriumdietilditiokarbamát

A táblázatból világosan kitűnik, hogy a kémiai analitikai módszerekkel volfrámfémben meghatározható legkisebb vas mennyiséget a szerzők 5-10 ppm-ben jelölik meg. Az  $5 \cdot 10^{-4} \%$  (5 ppm) mennyiségű vas meghatározása volfrámfém-ben jelenleg jogosan tekinthető a kémiai módszerekkel mérhető alsó határnak, márcsak a volfrámfém oldásakor a savakkal bevitt vasszennyezés miatt is.

Az általam végzett vasmeghatározások során pl. az oldáshoz használt savak vastartalma a következő volt:

cc  $\text{HNO}_3$  (MERCK) max.  $2 \cdot 10^{-4} \%$   
cc HF (MERCK) max.  $5 \cdot 10^{-5} \%$

Tehát, amennyiben 1 g volfrám-minta oldásához 5 g HF-t és 1,5 g  $\text{HNO}_3$ -at használtam, a bevitt vasszennyezés maximálisan 5,5 ug volt.

#### Nikkel

A volfrámgagyártásban a fém-oxidot Fe, Cr, Ni tartalmú csónakokban magas hőmérsékleten  $\text{H}_2$  áramban redukálják fémmé. Igy az oxid, majd a fémpor nagy felületen érintkezik a csőnak anyagával.

Lehetőség van a különböző fémekkel való szennyeződésre, melyek közül a Ni erősen leronthatja a bevezetőben említett hasznos volfrám tulajdonságokat,

A nikkel meghatározására vonatkozó irodalmi adatokat a 4. táblázat tartalmazza.

4. táblázat

Meghatározási módszer	Vizsgált koncentráció-tartomány, kíméletkísérlet-ság, hiba	Irodalom
Extrakció dimetil-glioxim-fotometriás mérés NaDDTC	10 - 50 $\mu\text{g}$ Ni	[40]
PAN extrakció-spektrofotometriás mérés	$5 \cdot 10^{-4} - 1 \cdot 10^{-2}$ % Ni	[41]
Dimetilglioxim extrakció fotometriás mérés	(1-25) . $10^{-4}$ % Ni st.dev. 5%	[42]
Kationcsere- fotometriás mérés dimetilglioxim	$5 \cdot 10^{-5}$ % Ni (0,5 g W-ból)	[43]
Elválasztás nélkül - fotometriás mérés dimetilglioxim	$10^{-4} - 10^{-3}$ % Ni (5-10 g W-ból)	[44]
Extrakció NaDDTC-fotometriás mérés dimetilglioxim	Érzékenység: $2 \cdot 10^{-6}$ % Ni Addiciós mérés: 5-25 $\mu\text{g}$ Ni	[39]

## Molibdén

A molibdén tulajdonságaiban a volfrámhoz nagyon hasonló, magas olvadáspontú fém. A gyártás alapanyagául szolgáló tisztított volfrámsavban ill. ammoniumparavolframában 0,01% alatt kell lenni a molibdén-tartalomnak. Ez az érték a technológiai folyamat során csökkenhet, de nyomai minden megtalálhatók a kész termékben, az izzószálban is. Az 5. táblázatban felsorolok néhány érzékeny molibdén meghatározási módszert.

5. táblázat

Meghatározási módszer	Vizsgált koncentrációtaromány, kimutathatóság, hiba	Irodalom
Fenilhidrazin - fotometriás mérés		[45]
Dithiol <sup>(1)</sup> extrakció-spektrofotometriás meghatározás	5-15 µg Mo ± 2 %	[46]
Elválasztás ( $\text{MoS}_3$ ) - fotometriás mérés, dithiol	Érzékenység: $1 \cdot 10^{-5}$ % Mo Max. hiba: 1,5%	[47]
Elválasztás nélkül fotometriás mérés, $\text{Mo(V)}$ - tiocianát	$10^{-3}$ % Mo min. 0,2 g W-ból	[48]
$\text{Mo(V.)}$ - tiocianát-extrakció spektrofotometriás mérés	0,001 - 0,160% Mo (< 40 µg Mo)	[48a]

(1) Dithiol - Toluol-3,4-dithiol

## Szén

A vákuumtechnikai volfrámhuzal törékenységét elsősorban a széntartalomnak tulajdonítják. Bár ez a nézet a legutóbbi időben módosításra szorult [55], a széntartalom vizsgálatának szerepe mégsem vesztett fontosságából.

A szén meghatározása két alapvető lépésből áll:

1. A szén felszabadítása és eloxidálása oxigén áramban magas hőmérsékleten történő égetéssel, vagy savas oxidáló oldással.
2. A keletkezett  $\text{CO}_2$  elnyeletése és meghatározása térfogatos mérésel, vezetőképességméréssel, vagy savbázis titrálással.

6. táblázat

Meghatározási módszer	Vizsgált koncentrációtartomány, kimutathatóság, hiba	Irodalom
Égetés- $\text{CO}_2$ mérés sav-bázis titrálással		[49]
Égetés- $\text{CO}_2$ mérés konduktometriásan	$0,001\% \text{C} \pm 16\%$ $4 \cdot 10^{-4}\% \text{C}$ (4gW-ban) 12%rel.	[50] [51]
Égetés- $\text{CO}_2$ térfogat mérése	$0,097 - 2,44 \% \text{C}$ (5-100 mg minta)	[52]
Savas oxidáló oldás - $\text{CO}_2$ mérés sav-bázis titrálással	A felhasznált minta mennyisége: 1 - 2 g W ill. 50 - 60 mg WC	[53 - 54]

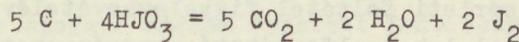
A széntartalom kvantitatív felszabadítása szerves vegyületekből és a különböző fémekből, acélok ból nem jelent különös nehézséget az emlitett égetési módszerrel. Az irodalmi adatok tanúsága szerint volfrámfém esetében azonban csak számos kísérleti feltétel figyelembevételével és szigorú betartásával lehet elfogadható eredményeket elérni.

W.A. Gordon és munkatársai [5] , - akik 10 ppm-nél kevesebb széntartalom meghatározására dolgoztak ki eljárást - a következőre hivták fel a figyelmet:

1. A szén kvantitatív meghatározása alkalmas zónázó eljárással tisztított volfrámfém esetén a tisztítási folyamat hatásosságának jellemzésére.
2. A gyors felfütést és a kevéssé viszkózus keverék kialakulását biztosító adalékanyagok (vas, ón) alkalmazását, - mely számos fém és ötvözet esetében szükséges [5a, b] - volfrám esetében elhagyták.
3. A poritott fémminta méretét szigoruan a megadott határ alatt kell tartani, mert indukciós hevitést alkalmazva az energiaátvitel elsősorban felületi jelenség. A porítás során a mintába került jelenős mennyiségi vasat sósavas mosással el kell távolítani, mert erősen befolyásolja a meghatározásokat.
4. A vezetőképesség-mérés körülményeit is szigoruan előirják: Az állandó oxigénáramnak kitett báriumhidroxid oldat vezetőképesség-változása 30 perc alatt nem lehet több 0,1 ohm-nál, a kemence felfűtési ideje alatt pedig nem lehet több 0,3 ohm-nál.

Sigeru Ohaski [54] által szerves vegyületek széntartalmának meghatározására leírt módszert alkalmazta Jusaku Machida és munkatársa [53] volfrámfém és volfrám-karbid

széntartalmának meghatározására. A módszerrel 1-2 g volfrám-huzal,- vagy 50-60 mg volfrámkarbidból savas oxidáló oldás-sal szabadítják fel a széntartalmat a következő reakcióegyen-let szerint:



A felszabadult  $\text{CO}_2$ -t, spirál-tipusu elnyeletőt alkal-mazva 0,1 N NaOH-ban elnyeletik.  $\text{BaCl}_2$  adagolása után a lug felesleget 0,1 N HCl-lel visszamérik timolkék indikátor je-lenlétében. A felszabadult jódot vizmentes nátriumtioszulfát-tal nyelik el, hogy ezáltal elkerüljék a jódnak az elnye-letőbe jutását.

A meghatározható széntartalom a következő adatokkal jelle-mezőhető:

1,0 ml 0,1 N NaOH      600  $\mu\text{g}$  C-t mér.

### Összefoglalás

A korszerű volfrámkutatás igényli a kémiai analitikai módszerek fejlesztését, új érzékenyebb és pontosabb megha-tározási módszerek kidolgozását.

Legfrissebb irodalmi adatok [5] arról számolnak be, hogy az u.n. Auger-spektroszkópia alkalmazásával összefüg-gést találtak a volfrám-drótok törékenysége és foszfor tar-talma között.

A volfrámgyártásban az idegen anyagok hatásmechanizmu-sának felderítése céljából Millner Tivadar és munkatársai rendre új adalékanyagokat alkalmaztak, (ilyenek pl. Ga, Tl) és a kész termékeken részletes vizsgálatot végeztek. (Ga: Magy. szab. 152.086; Tl: Magy. alapszám: MA 1629). Az új ada-lekanyagok alkalmazása minden esetben új elemzési feladatok megoldását tette szírkégesse [56 58]. Ezek ismertetésére je-len munkában nem térek ki.

### I r o d a l o m

- [1] Millner T.: A vákuumtechnikai volfrámfém előállításának és tulajdonságainak természettudományos kérdései. Székfoglaló előadás a MTA-n (1956. III. 5.) Acta Technika XVII.
- [2] R. Dyck; T.J. Veleker: Anal. Chem. 31, 390-2 (1959).
- [3] O.F. Degtyareva; M.F. Ostrovskaya: Zh. Analit. Khim. 18, 245-9 (1963).
- [4] A.N. Shtenberg: Metody Analiza Khim. Reaktivov i Preparatov, Gos. Kom. Sov. Min. SSSR po Khim. No 7, 77-81 (1963).
- [5] T.M. Moroshkina; A.M. Serbina: Zh. Prikl. Spektroskopii, Akad. Nauk. Belorussk. SSR. 4/3/ 270 (1966).
- [6] Farrar R.B.; Randolph D.C.S.; Sullivan, H.H.: U.S. At. Energy Comm. 1967. K-1683. Avail. Dep. CFSTJ, 41 pp.
- [7] Pevstsov G.A.: Metody Anal. Khim. Reaktivov Prep. 1968 No. 15, 61-3.
- [8] Cosgrove, J.F.; Morrisson G.H.: Anal. Chem. 29, 1017 (1957).
- [9] H.Grosse-Ruyken; H.G. Doege: Talanta 12/1/, 73-80 (1965).
- [10] Ch.Engelmann; J.Gosseb; M.Loenillet: Mem. Sci. Rev. Met. 63/12/, 1081-5 (1966).
- [11] H.G. Doege: Anal. Chim. Acta 38/1-2/, 207-11 (1967).
- [12] Pinte, Guy: Commis. Energ. At. (Fr), Rapp. 1967 CEA-R 3267, 67 pp.
- [13] Doege, Hans G.; Grosse-Ruyken, Heinz: Izotopenpraxis 1968, 4(7), 262-8.
- [14] A. Elek; E. Szabó: Acta Chim. Acad. Sci. Hung. 57/4/, 385-9 (1968).

- [15] Hegedüs, A.; Dvorszky M.; Neugebauer J.: Magy. Kém. Folyóirat 65, 159-64 (1959).
- [16] A.J. Hegediis; K. Fukker: Mikrochim. Acta 1962, 357-64.
- [17] N.V. Bausova; G.A. Resketnikova: Tr. Inst. Khimi. Akad. Nauk SSSR Ural Filial No. 10, 103-6 (1966).
- [18] J.A.F. Gidley: Limitations Detection Spectrochem. Anal., Papers Conf., Exeter, Engl. 1964, 25-44.
- [19] Donaldon E.M.; Charette D.J.; Rolko, Vera H.E.: Talanta 1969, 16/9/ 1305-10.
- [20] E.F. Spano; T.E. Green; W.J. Campbell: U.S. Bur. Mines, Rept. Invest. No. 6565/12/, 16 pp (1964).
- [21] Major T-né; Gadó P.: Magy. Kém. Folyóirat 74, 196 (1968).
- [22] Püschel, Richard; Lassner Erik: J. Less-Common Metals 1969, 17/3/ 313-17.
- [23] L. Moenke-Blankenburg; H. Moenke: Glas-Instr.-Tech. 10/2/, 85-8 (1966).
- [24] A. Corme; R. Bourguillot; R. Stefani: Energ. Nucl. 9/6/, 386-93 (1967).
- [25] Kolhaas, Erick; Scheiding, Frank: Arch. Eisenhuettenw. 1969, 40/1/, 47-51.
- [26] Millner T.; Neugebauer J.: Magy. Kém. Folyóirat, 57, 321-330 (1951)
- [27] V.F. Malcev; L.P. Lukjanenko: Zavodskaya Lab., 27, 807-8 (1961).
- [28] Gentry C.H.R., L.G. Sherington: Analyst 71, 432 (1946).
- [29] Danneil, A.: Techn. wiss. Abh. Orsam-Ges., Bd. 7. S. 350. Berlin-Göttingen-Heidelberg: Springer 1958.
- [30] Gurlova, M.N.: Opred. Mikroprimesei 1968, No. 2, 13-20.

- [31] V.G. Shcherbakov; Z.K. Stegendo: Sb. Tr. Vses. Nauchn.-Issled. Inst. Tverd. Splavov 1964/5, 281-8.
- [32] B. Bagshawe; R.J. Truman: Analyst 79, 17-23 (1954).
- [32a] A.S.T. M. Methods for Chemical Analysis of Metals, Am. Soc. for Testing Materials, Philadelphia, 1956, p. 198.
- [33] Crawley, R.H.A.; M.L. Aspinall: Analyt. chim. Acta 13,376 (1955).
- [34] Gahler A.R.; R.M. Hammer; R.C. Shubert: Analyt. Chem. 33,1937-41 (1961).
- [35] Elsie M. Penner; W.R. Inman: Talanta 9, 1027-36 (1962).
- [36] G.Nowitz; H.Gordon: Anal. Chem. 37/3/, 417 (1965).
- [37] R.Püschel; E.Lassner; K.Katzengruber: Chemist Analyst 56/3/, 63-5 (1967).
- [38] Buxbaum P.: MÜFI közlemények 0-2, 27 (1969).
- [39] Szücs P.-né; Klug O.: Magy. Kém. Lapja 6,323-6 (1969).
- [40] Kenneth L. Rohrer: Anal. Chem. 27,1200-3 (1955).
- [41] R. Püschel; E.Lassner: Mikrochim. Ichnoanal. Acta 1965/1/, 17-20.
- [42] Thomas E. Green: Anal. Chem. 37/12/ 1595-6 (1966).
- [43] O.Grossmann; H.G. Doege; H. Grosse-Ruyken: Z. anal. Chem. 219/1/, 48-53 (1966).
- [44] K.D. Hodylevskaya: Zavodszkaya Lab., 33/8/, 948-9 (1967).
- [45] Ernst M. Goldstein: Chemist. Analyst 45,47-9 (1956).
- [46] Jeffery P.G.: Analyst 82, 558 (1957).
- [47] H.Buss; H.W. Kohlschütter; S. Miedtank: Z. anal. Chem. 178, 1-11 (1960).
- [48] F.S.Grimaldi; R.C. Wells: Ind. Eng. Chem. Anal. Ed., 15,315 (1943).

- [48a] C.L. Luke: Anal. Ghim. Acta 34/3/, 302-7 (1966).
- [49] S.A. Aruina: Zavodskaya Lab., 12,411-14 (1946).
- [50] V.G. Shcherbakov; Yu. N. Yurkevich: Sbornik Trudov Vsesoyuz. Nauch. - Issledovatel. Inst. Tverd. Splavov: 1,332-40 (1959).
- [51] William A. Gordon; Judson W. Graab; Zita T. Tumney: Anal. Chem. 36/7/ 1396-98 (1964)
- [51a] Elwell, W.T.; Wood, D.F.: "The Analysis of Titanium, Zirconium and their Alloys", p. 23, Wiley, 1961.
- [51b] Huber, F.E.: Chase, D.L.: Chemist Analyst 50,71 (1961).
- [52] Jack W. Frazer; Richard T. Holzmann: U.S. At. Energy Comm. UCRL-6020, 7 pp (1960).
- [53] Jusaku Machida; Nobuyuki Sugishita: Nippon Kagaku Zasshi 79,528-31 (1958).
- [54] Shigeru Ohashi: Bull. Chem. Soc. Japan: 28, 585-8 (1955).
- [55] A. Joshi, D.F. Stein: Metallurgical Transactions 1,2543-46 (1970).
- [56] P. Buxbaum; K.G. Vadasdi: Photometric determination of small quantities of Ga in tungsten. Chemia Analytyczna (Warsaw) 14,429 (1969).
- [57] K.G. Vadasdi: The determination of Ga in the presence of tungsten. Chemia Analiticzna (Warsaw) 14,733 (1969).
- [58] Vadasdi K.; Buxbaum P.; Salamon A.: The determination of small amounts of Tl in tungsten Anal. Chem. Megjelenés alatt.

NÉHÁNY MEGFIGYELEM GÁZTÖLTÉSŰ IZZÓLÁMPÁKBAN FELLÉPŐ  
ÍVKISÜLÉSEKRŐL

GEREY Gyula, HAMMER Ferenc, SZÉNFY Ella

MTA Műszaki Fizikai Kutató Intézet, Budapest

Az izzólámpák gázterében fellépő ívkisülésjelenség az izzólámpagyártás és felhasználás állandóan jelentkező káros kísérője. Elektromos ív az izzólámpában kétféle módon jöhet létre. Egyik formája a volfram elpárolgása folytán, az izzótest élettartama végén beálló helyi keresztmetszetcsökkenés, az u.n. spotjelenség következménye: az elvékonyodott spirál-szakasz túlhevülése és megszakadása helyén ív alakul ki. Másik formája az élettartam bármely szakaszában, akár a kezdetén is, a spirál két pontja, vagy a spirál egy pontja és valamelyik áramvezető között alakul ki; ez utóbbi a lámpatöltő gáz ionizációjának, vezetővé válásának következménye. A továbbiakban csak ezzel a jelenséggel, az izzólámpák korai kiégésének leggyakoribb okozójával foglalkozunk. Az ívképződési hajlamot növeli a zsúfolt izzótest-elrendezésből, a többszöri spiralizálásból eredő nagyobb feszültségradiens, a kisebb átütési szilárdságú töltőgáz alkalmazása, valamint egyes gyártási eljárások, vagy esetleges technológiai hibák következtében az izzólámpa belséjébe kerülő könnyen ionizálódó szennyezések termikus ionizációja, ionemissziója [1].

Hirtelen felizzításnál a spirál környezetében az emitált pozitív ionok koncentrációja oly mértékben megnövekedhet, hogy az izzótestet körülvevő gázréteg vezetővé válik, s ez ív kialakulására vezet. Az izzó volframfonal 2600 K<sup>0</sup>-nál nagyobb üzemi hőmérsékleten 1 us nagységrendű idő alatt

impulzusszerűen  $10^6$  pozitív iont is emittálhat (ion-burst) [2]. Az ionizált formában emittálódó szennyezés legnagyobb részben nátrium és kálium, de kisebb mennyiségben rubidium, kalcium és aluminium is kimutatható. A fém felületén lévő, legnagyobb részben nátriumsókból álló ionszennyezés az izítás kezdetén nagy mennyiségben mindaddig távozik a volfram felületéről, amíg készletei ki nem merülnek.

A kálium ionok emissziója nemcsak a volfram felületén lévő forrásból történhet.

A volframtrioxidhoz a fém mechanikai tulajdonságainak befolyásolása céljából a redukció előtt adalékanyagokat, a többi között néhány tized-század % káliumoxidot kernek. Az adalékanyagok egy része a porkohászati eljárás során a fém belsejében marad és a kristályhatárokon dusul fel. Az ionszennyezések az izzótest belsejéből a lámpa működése folyamán lassan a felületére jutva, kis intenzitással folyamatosan emittálódnak a gáztérbe. Az emittált pozitív ionok száma a fém kristályszerkezetétől is függ: különösen az él-diszlokációk sűrűségével, a krisztallitok számával növekszik nagymértékben. Ezért ebből a szempontból is előnyösnek tartjuk, hogy a lámpa előégetése folyamán diszlokációkban szegény, nagykristályos szerkezetű volfram izzótest jöjjön létre.

Intézetünkben többféle kezelési eljárást, illetve berendezést dolgoztunk ki izzólámpák ívelési hajlamának csökkentésére, és jelenleg is folynak kísérleti munkáink e területen.

Winter Ernő már a harmincas években foglalkozott az izzólámpák ívelésjelenségével, és találmányi megoldást dolgozott ki az ívelési hajlam csökkentésére [3], nagy diszperzitásfokú sziliciumdioxidnak a volframspirálra való felvitele útján. A Műszaki Fizikai Kutató Intézetben folyó

kutatások kezdetén felismertük azt a tényt, hogy az izzólámpa első bekapcsolásánál, az ú.n. előégetésnél az ivelési hajlam csökkenhető a spirálnak üzemi hőmérsékleténél magasabb hőfakra való gyors felizzítása által. A nagykristályos szerkezet kialakítására alkalmas, ú.n. GK-volframdrót a rekrisztallizáció hőmérséklettartománya,  $2400-2500\text{ }^{\circ}\text{C}$  fölé hirtelen felizzítva nagyobb-kristályos szerkezetűvé alakul, mint fokozatos, lassú felhevítés esetén, a hirtelen felszabaduló, ionizált állapotban lévő szennyezőgázkat pedig az egyidejűleg elpárolgó getter irreverzibilisen köti meg. E felismerés alapján az izzólámpagyártásban eddig alkalmazott "fokozatos" előégetés helyett új kezelési eljárást dolgoztunk ki [4].

Ennek az új kezelési eljárásnak a gyártó gépsoron való alkalmazását könnyíti meg az az Intézetünkben tervezett és kivitelezett elektronikus előégető berendezés [5], amely a romboló ivelés kialakulását meggyártva lehetővé teszi az előégetésnek a névleges feszültséggel, vagy szükség esetén ennél nagyobb feszültség közvetlen rákapsolásával való végzését.

A romboló iv kialakulása más módon is meggyártolható, például az előégetendő izzólámpának leivelésre nem hajlamos lámpával való sorbakapsolásával és kétszeres feszültsségű, alkalmas impedanciájú áramforrásról történő táplálásával [6].

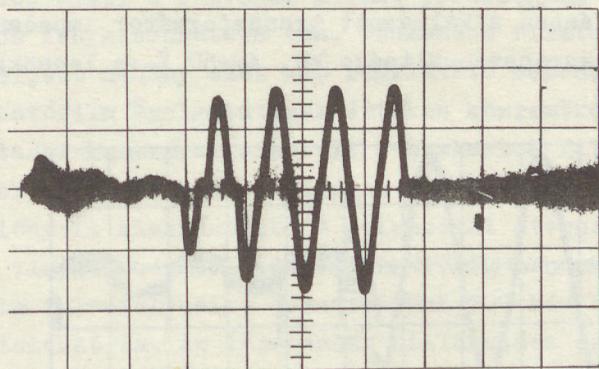
Az iv kialakulására vezető fizikai folyamatok rendszeres tanulmányozásának különösen nagy jelentősége van a káros jelenség okainak feltárásában. Intézetünkben több év óta folynak rendszeres kutatások a jelenség és az azt előidéző tényezők alaposabb megismerésére. Ennek a munkának egy kisebb, de lényeges fejezetéről, az ivkeletkezés folyamatának nagysébességű filmfelvétel-tecnika segítségé-

vel történő vizsgálatáról számolunk be ezúttal. Az iv kialakulását és lefolyását váltakozó feszültséggel vizsgáltuk, minthogy a jelenség leginkább a 220 V, vagy e feletti feszültségű (50 Hz) hálózatról táplált izzólámpáknál lép fel tömegesen, és annak, hogy a váltakozófeszültség pillanatnyi értéke a periódusidő jelentős hányadában nagyobb az effektív feszültségnél, a kisülés megindításában feltétlenül szerepe van. A leivelés folyamatának megfigyelése, az áram- és feszültség-oszcillogrammok felvétele kezdetben leküzdhetetlenek látszó nehézségeket okozott, mivel az előégetett, kész izzólámpák leivelésének időpontja előre meg nem határozható, véletlenszerű. A megoldást arra (az izzólámpagyártás gyakorlatából jól ismert) jelenségre alapoztuk, hogy a gáztöltésű duplaspirálú lámpák előégetés nélkül, közvetlenül a névleges üzemfeszültségre bekapcsolva belső ivelés folytán igen nagy valószínűséggel tönkremennek. (Az előégetés az izzóspirálok igen lassú, fokozatos felizzítását jelenti az üzemhőmérsékletnél nagyobb végső hőmérsékletig.) A névleges feszültségen kialakuló iv képe és áramköri jellemzői nagysebességű filmfelvétellel, ill. katódoszcilloszkóp-ernyő fényképezése útján csak abban ez esetben rögzíthetők, ha a leivelés az izsitó áramkör zárásával egyidejűleg indított felvétel, illetőleg a katódsugár - lefutási idején belül megtörténik. 220V névfeszültség esetén a felfűtés kezdetétől legalább 0,5 - 1 másodperc telt el az iv kialakulásáig, ezért a feszültség növelésével ezt az időtartamot csökkenteni kellett. 5% feszültségnövelés hatására az ivelést megelőző időköz 200-210 ms-ra, 10% túlfeszültség hatására pedig 50-60 ms-ra, tehát mintegy három periódus időtartamára csökkent.

A feszültség- és áram oszcillogramok alapján az iv begyűjtása mindig az áram- illetve feszültségcsúcs közelében történik, ezért az első ivelési áramlökés időtartama egy-negyed-egyharmad periódus időnél (5-7 ms) soha nem hosszabb,

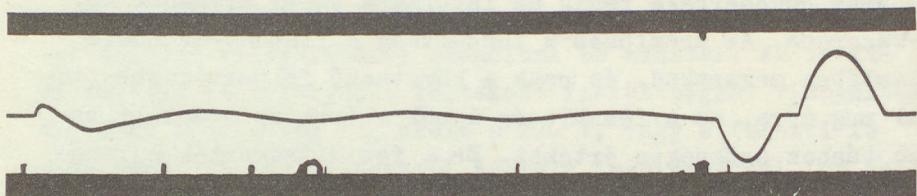
az áram csúcsértéke pedig az izzólámpa égési áramának kb. 6-8szorosa. Az áramlökés a feszültség nullapont-átmenete közelében megszakad, és csak a következő félperiódusban indul meg újra, ha a feszültség újból elérte az ismételt begyújtáshoz szükséges értéket. Ez a feszültségérték újrabe-gyújtás esetén a csúcsértéknél kisebbé válik, az áramlökés időtartama megnő, áramerőssége pedig eléri az égési áram-felvétel 10-16-szorosát is.

Az ismétlődő begyújtások számát a biztosító szál meg-olvadása, illetve az ionok rekombinációja korlátozza: ki-sérleteinkben az 1-2 félperióduson után megszakadó ívelések-től a több perióduson át fennmaradó ívkisülésekig sokféle változat fordult elő. Az áramlökések közötti "ívárammentes" szakaszok a felvételeken jól felismerhetők.



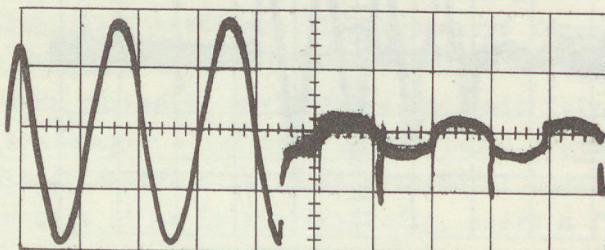
1. ábra

Készítettünk nagysebességű felvételi technikával -drum (dob) kamera segítségével - olyan ú.n. sávfelvételeket is, amelyeken az iv megszakadásától az újra begyújtásig eltelt időszak sokkal szemléletesebben bemutatható.



2. ábra

Az áramgörbékkel párhuzamosan felvett feszültségoszcillogramokon jól felismerhető, hogy az első ívlökés valóban a feszültségmaximum közelében alakul ki, és a nullapont átmenetnél szakad meg. Az íváram átfolyásának idején megfigyelhető továbbá a kapocsfeszültség növekedése az ív megszakadásától a következő begyújtásig. A nagy ionsűrűségű gázkisülés az izzólámpa belső ellenállását gyakorlatilag rövidzárrá csökkenti, úgyhogy a mintegy  $8\text{~A}$  íváramerősség-nél a kapcsolásban alkalmazott transzformátor impedanciáján az izzólámpa kapocsfeszültsége kb.  $40\text{--}50\text{~V}$ -ra lecsökken.



3. ábra

Az oszcillogram felvételek nem adhatnak információt az ív kialakulása előtti időszakról, az ivelés jelenséget előidéző folyamatokról.

Az eddig tárgyalt megfigyeléseink alapján megállapítható, hogy a vizsgált rendszerekben egy jól meghatározott minimális potenciálkülönbség - hőmérséklet értékpár együttes jelenléte szükséges az iv kialakulásához. Ez az oka annak, hogy az iv soha nem a feszültség bekapcsolásának pillanatában alakul ki, amikor a spirál még hideg, hanem csak azután, ha az izzótest a szükséges hőmérsékletet már elérte. A nagy áramerősségű ívelést megelőzően a felizzásban lévő spirál környezetében lejátszódó, az iv kialakulását bevezető folyamatok az oszcillogramokon nem tanulmányozhatók, mivel nem befolyásolják észrevehetően a feszültség- és áramgörbék alakulását. E jelenségek részletesebb vizsgálatára alkalmasabbnak bizonyult az "időmikroszkóp"-technika; nagysebességű filmfelvételek készítése magáról az ívelő izzó-lámpáról. A rendkívül nagy felvételi sebességet lehetővé tevő impulzus-megvilágítástechnika ebben az esetben nem alkalmazható, mivel a felvenni kivánt jelenségek saját folyamatos fénykibocsátása van. Szakaszos filmtovábbítással legfeljebb néhány száz kép rögzíthető másodpercenként. A MTA Kutatófilm Szolgálatának értékes közreműködésével, japán Hitachi kamerával sikerült a szakaszos filmtovábbítással jelenleg elérhető maximális 800 kép/mp felvételi sebesség előnyeit kiaknáznunk. A jelenséget ötvenszeres lassításban vizsgálva a váltakozó feszültség minden félperiódusra nyolc felvétel esik. Készítettünk 200 kép/mp sebességű felvételeket is. Az ivjelenség kialakulása és lefolyása ilyen nagymértékű lassításban minden részletében jól megfigyelhetővé vált. Lassított vetítés céljára készítettünk olyan kópiákat is, amelyek az eredeti felvétel minden képkockáját megtízszerезve tartalmazzák, azaz a vetítésnél 500-szoros látszólagos lassítást eredményeznek. Az iv kialakulásának és lefolyásának fontosabb fázisai ezekből a felvételsorozatból kiragadt néhány képkocka segítségével szemléltetően bemutathatók.

A névleges feszültségnél 10%-kal nagyobb tápfeszültségre közvetlenül bekapcsolt lámpákon az ív kialakulása előtti 50-60 ms, azaz 2,5 - 3 periódus tartamú időközben két jellegzetes szakasz volt megfigyelhető:

- a) a bekapcsolás utáni első 20 ms-ban csak a spirál felizzása látható
- b) 20 ms elteltével a hőmérséklet tovább növekszik, ekkor az izzólámpaspirál körül ködfényszerűen fénylő burok alakul ki, amely fényesebb belső és halványabb külső rétegekből áll és jól definiált külső hatáffelülettel bír.

4. ábra

A spirál körül kialakult fénylő burok helyzete a konvekció következtében egyre aszimmetrikusabbá, kiterjedése a spirál felett sokkal nagyobbá válik. Átmérője időben csaknem lineárisan növekszik az ív-kialakulás pillanatáig. Az 55. - 60. ms között a spirál körül, a világító burok belséjében pillanatszerűen ívmag alakul ki. Ezt legjobban két egymásutáni filmkockával lehet érzékeltetni, amelyek köztött mindössze 1,25 ms idő telt el.

5. ábra

Az ívmag kialakulása után a világító burok külső határa rohamosan kiterjed. Jól megfigyelhető az ívmag méreteinek periódikus változása és az ív kialvása a váltakozó-feszültség 0-pont-átmeneténél. A spirál végei rendszerint már az első áramlökés hatására megolvadnak, minthogy a kisülés áramsűrűsége a spirálvégeknél maximális. Az ív talppontja az eltávolodó spirálvégekről az áramvezető elektron-dákra helyeződött át.

6. ábra

Ezután a konvekció hatására az ívkisülés felfelé mozgul el, a talppont az iv legmélyebb pontjává válik, végül egyre fokozódó konvekciós áramlás mellett s biztosítószál kiolvadása következtében az ív-talppont megszakad.

A filmfelvételek és a többi vizsgálatok értékelése alapján az iv-kialakulás folyamatáról és a jelenség lefolyásáról az alábbi felismerésekre jutottunk:

- 1) gáztöltésű izzólámpák belsejében soha nem a bekapsolás pillanatában alakul ki elektromos iv, mivel az iv keletkezésének feltétele, hogy kellő koncentrációban jelenlévő alkálfémsó gőzök kellő hőmérsékleten termikus ionizáció révén ionállapotba kerüljenek; tehát a térerősség jelenléte magában nem elegendő, az ívet csak meghatározott izzótest-hőmérséklet és elektromos térerősség együttesen válthatja ki. Ezért befolyásolja olyan nagy mértékben az áramkör zárasától a leivelésig eltelt időt a feszültség kis mértékű megváltoztatása.
- 2) Az ívelést kiváltó térorősség-hőmérséklet értékpár példányonként változó: értéke többfélé tényező együttes

hatásától függ, ezek között a legdöntőbb befolyása a könnyen ionizálható alkáliszennyezések anyagi minőségének és koncentrációjának van. Alkálisó szennyezések jelenlétében bizonyosnak tekinthető, hogy míg az ívelést bevezető ködfényszerűen világító burok megjelenésekor az alkálifém ionok keletkezése már megindult, addig a töltőgáz ionizációjának ezen a hőmérsékleten, az ivképződést megelőző szakaszban még nem lehet döntő szerepe. A felizzó spirál közvetlen környezetében, az ú.n. Langmuir-retegen az alkálifém ionok pillanatnyi koncentráció értékének az iv kialakulását eldöntő szerepe van. Az alkálifém ionok helyi feldúsulásának mértékét az ionképződés és az ionok rekombinálódása, illetőleg a forró gáztérből való eltávozása közötti dinamikus egyensúly határozza meg, ezért egy adott szennyezési szint mellett kialakuló maximum értéke elsősorban a felfűtés sebességétől függ. A töltőgáz fajtájának és nyomásának, mint az ütközési számot, diffúziót, konvekciót meghatározó tényezőknek szerepe szintén nem elhanyagolható.

- 3) A nagy áramsűrűségű ivmag kialakulása az izzótest legmagasabb hőmérsékletű helyein, a szekunder spirál belséjében, illetőleg menetei között indul meg, majd - mint a kettős filmkockán (5. ábra) jól megfigyelhető - az izzóspirált körülvevő kisülési csatornává alakul. A kisülés magjában a töltőgáz atomjainak lavinaszerű ionizációja indul meg, a töltéshordozók száma hirtelen megsokszorozódik, a hőmérséklet megnövekszik. A kisülési áram a lámpa névleges izzítóáramának 10-15-szörösét is elérheti egynyolcad periódusnál ( $2,5$  ms) rövidebb idő alatt. Ilyen körülmények között a spirál végei már az első áramlöökés hatására megolvannak, az izzólámpa tönkremegy.

## AZ IV KIALAKULÁSÁNAK MEGGÁTLÁSA

A belső ívképződés romboló hatásának elkerülésére a fentiek alapján csak olyan eljárás vagy védőkapcsolás alkalmas, amely a nagy áramerősséggű ív kialakulását lehetetlenne teszi. Ez vagy oly módon történhet, hogy az ionlívána képződésének előfeltételét jelentő könnyen ionizálódó szennyezőatomokat eltávolítja, ill. hatástalanítja, vagy pedig olyan áramköri megoldás segítségével, amely az izzólámpa felizzása közben kialakulóban lévő ívet az első nagy áramlökés kezdeti szakaszában visszafojtja, megszünteti.

- a) az izzólámpa belséjébe igen sokféle forrásból juthatnak alkálfém- vagy sószennyezések: a volfram izzótest anyagába szándékosan bevitt adalékoktól, az alkatrészek felületéről el nem távolított, vagy a gyártási segédanyagokkal bekerült ionvegyületekig. Kisérleteink alapján nyilvánvaló, hogy a könnyen ionizálódó szennyezések tökéletes eltávolitása, illetve távoltartása a káros jelenség teljes kiküszöbölését eredményezné. A rejtett szennyezási források kiküszöbölése és az extrém tisztasági követelmények betartása igen nehéz feladat, hiszen, különösen a koncentrált izzótestű, magas hőmérsékletű és feszültségű izzólámpák nál az ivelést előidéző alkálisó mennyiség század-ezred mikrogram körül lehet; ilyen csekély mennyiség kimutatása is csak különleges módszerekkel lehetséges. A technológiai nehézségek ellenére a belső szennyezések mennyiségének csökkenése feltétlenül szükséges, mivel bizonyos szint felett az izzólámpák ivleégési hajlama a gyártásnál alkalmazott ivelésgátló eljárások ellenére hosszabb-rövidebb tárolás után, vagy a fogyasztónál jelentősen megnő.

b) Az előbbi mondatokban össze is foglaltuk véleményünket mindenekről az irányzatokról, amelyek csupán az izzólámpa első felizzításánál (ú.n. előégetésénél) bekövetkező ivelések elkerülését célozzák anélkül, hogy a belső ionszenyezések kiküszöbölésével törődnének. Ebbe a csoportba sorolható még az a szokásos előégetési eljárás is, amelynél a lámpákat a névleges feszültség 60%-ától 5-10%-os lépcsőkben növelt feszültséggel fokozatosan izzitják fel.

A lassú felfűtésnél a spirálra került, vagy belőle ki-diffundáló szennyezéseknek elegendő ideje van ahhoz, hogy az izzó spirál közeléből a zárt rendszer hidegebb részeire távozzanak anélkül, hogy a forró gázrétegben az ív-keletkezéshez elegendő ionkoncentráció alakulhatna ki. A rendszer hidegebb részein lecsapódott ionszenyezések, amelyeket a nedvesség- és oxigénnyomok megkötésére alkalmazott getteranyagok nem befolyásolnak, a tárolás, ill. a használat folyamán ismét a volframspirálra kerülnek, váratlan ivleégést okozva. Az ionszenyezések visszajutásának mechanizmusa részleteiben még további tisztázásra szorul.

A tömeggyártás során, a fokozatos előégetés ellenére több-kevesebb izzólámpa leívelés következtében megy tönkre. Tájékoztató jellegű, kis darabszámú kísérletet végeztünk annak megállapítása céljából, milyen mennyiségi ionvegyület idéz elő ivleégést a fokozatos előégetés körülményei között. A 220 V/100 W gáztöltésű normál lámpákkal végzett kísérletek azt mutatták, hogy az 5 mikrogram NaCl-szenyezést tartalmazó lámpák a névleges feszültség 90%-ánál, a 10 mikrogram NaCl szennyezéssel készített példányok a névleges feszültség 85%-ánál kivétel nélkül leívelnek. A szándékos szennyezést nem tar-

talmazó pafallel sorozatból a névleges feszültség eléréséig egy darab sem ivelt le. A kálium ionok ivkeltő hatása a nátriumsókénál nagyobb, mivel ionizációs potenciáljuk a nátriuménál kisebb.

- c) Ivleégést gátoló anyagok alkalmazásáról már a bevezetésben említést tettünk. E helyen röviden a töltőgázelegy összetételének és nyomásának hatására is ki kell törnünk, mivel korábban pusztán ennek változtatásával kivánták elérni az ivelési hajlam csökkentését. Ismeretes, hogy az izzólámpák töltésére alkalmazott nemesgázok annál jobban csökkentik a spirál párolgását, minél nagyobb atomsúlyúak. Atomsúlyuk növekedtével csökken a hővezetőképességük is, ami ugyancsak előnyös az izzólámpa fényáram-hatásfokának növelése szempontjából.

A nagyobb atomsúlyú nemesgázok hátrányos tulajdonsága, hogy könnyebben ionizálhatók, mint a kisebb atomsúlyú neon vagy argon. A többatomos gázok közül leggyakrabban a nitrogén kerül lámpatöltőgázként alkalmazásra; ennek átütési feszültsége a tiszta argonének négyeszerese. Bár a nitrogén hővezetőképessége nagyobb, belső súrlódása kisebb, mint a szóbanforgó nemesgázoké, - ezért több hőt von el az izzó spiráltól vezetés és konvekció útján - mégis mind tisztán, mind adalékként gyakran alkalmazzák, éppen az ivelési veszély csökkentésére. Tudunk kell, hogy a töltőgáz összetételének megváltoztatása, vagy nyomásának egy atmoszféra fölé való növelése nem szünteti meg az ivképződés veszélyét, ha a rendszerben az alkáli szennyezési szintet egy kritikus érték alá nem csökkentjük. Az ivelésgátló szilárd anyagok hatásmechanizmusáról egyenlőre csak közvetett tapasztalatok állnak rendelkezésünkre. A vizben oldhatatlan savképző oxidok, mint pl. a szilíciumdioxid mérési

adataink alapján mind vákuumban, mind argonban csökken-  
tik a volfram elektronemisszióját, növelik kilépési mun-  
káját. A sziliciumdioxidot ennél a mérésnél felhevithet-  
tő segédelektródáról (készlet-spirálról) párologtattuk  
a mérődióda volfram katódspiráljára. A kilépési munka  
megnövelése egymagában nem magyarázná meg azt a többek  
által [3, 4, 7] észlelt tartós leivelésgátló hatást,  
amelyet saját kísérleti eredményeink is igazolnak. Igaz  
valószinű, hogy a finom eloszlású, nagy felületű szili-  
ciumdioxidnak a káros szennyezések kémiai megkötésében  
is szerepe van, esetleg az izzó volfram felületén, il-  
letőleg a forró gázterben lejátszódó kémiai reakciók  
révén. Mivel a spirálra felszíntartott sziliciumdioxid az  
előégetéskor legnagyobb részben elpárolog és a lámpa  
belőjének hidegebb pontjain csapódik le, nem tekint-  
hető véglegesen tisztázottnak, milyen folyamatok révén  
fejti ki tartós ivelésgátló hatását. A legvalószinűbb  
feltevés, hogy a sziliciumdioxid előégetéskor a spirál  
felületén lévő alkáliákat megkötve, vegyület alakjában  
juttatja a ballonfalra, ahol azok az üveg felületével  
kémiai kötésbe került szilikátorok alakjában tartósan le-  
kötve maradnak. Eddig elvégzett vizsgálataink eredménye  
alapján a  $\text{SiO}_2$  ivelést gátló hatását az alkáliszennye-  
zések szintjének növekedése ellenőrizheti, vagyis  
tartós hatás csak kismértékben szennyezett izzólámpák  
esetén várható.

- d) Leivelésgátló kapcsolások alkalmazása. Az előégetésnél  
bekövetkező leivelések megakadályozására mind a vizsgá-  
latoknál, mind a termelésben sikkerrel alkalmazhatók a  
különféle elektromos ill. elektronikus leivelésgátló  
kapcsolások [8]. Nem kívánunk e cikk keretében részle-  
tesen foglalkozni sem magukkal a kapcsolásokkal, sem  
működésük elvi ismertetésével; erről bővebb leírás az

idézett irodalomban és találmányi leírásokban [4, 5] található. Valamennyi ilyen kapcsolásnak közös vonása, hogy a lámpa belsejében a nagy áramerősségi iv kialakulását az átfolyó áram korlátozásával vagy az izzólámpa pillanatnyi rövidrezárásával lehetetlenné teszi. A leívelésgátló kapcsolások szükségtelenné teszik a lassú, fokozatos előégetést, mivel alkalmazásukkal a lámpák még a névleges feszültséget 20-30%-kal meghaladó feszültségre közvetlenül rákapcsolva sem mennek tönkre. A túlfeszültséggel, hirtelen előégetett lámpák az eddigi kissérleti tapasztalataink alapján minden leívelési hajlamuk, minden világítástechnikai jellemzőik szempontjából kedvezően viselkednek. Ennek legvalószínűbb oka, mint már a bevezetőben szóltunk róla, hogy a spirálnak a volfram rekrisztallizációs hőmérséklete fölé történő hirtelen felhevítésénél kedvezőbb kristályszerkezet alakul ki és a fémfelületen lévő könnyen ionizálható szennyezések eltávolítása is tökéletesebb. Kétségtelen, hogy az előégetés bármilyen kedvező körülményei sem ellenílyezhetik a gyártási anyaghibák, sérülések, továbbá a nagyobb mennyiségen a rendszerbe került könnyen ionizálódó szennyeződések ivkeltő hatását. Az izzólámpa belsejébe került csekély alkáli-ionszennyezés mennyiségi kimutatására csak igen finom laboratóriumi eljárások alkalmasak. Üzemeli körülmények között készülő lámpák rendszeres, gyártás közbeni vizsgálatára a kémiai elemzésnél alkalmasabb módszert kellett keresnünk. A vizsgálóeszköz megtervezésénél abból kellett kiindulnunk, hogy minden magas feszültségű gáztöltésű izzólámpában létrehozható iv, ha egy meghatározott, - az ionszennyezés mértékétől függő - leívelési feszültségnél nagyobb feszültségre kapcsoljuk be.

A leivelési feszültségérték meghatározása az izzólámpa tönkretétele nélkül is történhet megfelelő védőkapcsolás segítségével. Ez az érték jellemző a rendszerbe bármilyen úton bejutott tisztatlanságok kémiai összetételére és mennyiségrére, tehát alkalmas az anyaghibák vagy technológiai hiányosságok következtében váratlanul megnövekedő ivelési hajlam jelzésére, lehetővé téve annak idejében történő felismerését és elhárítását. A leivelésgátló kapcsolások üzemserű alkalmazása jelenleg még kísérleti stádiumban van. A kezelés optimális időtartama és feszültség- ill. hőmérséklet-adatai nagy mértékben befolyásolhatják az előégetés hatását. Az azonban bizonyos, hogy semmiképpen nem lehet elvárni az így előégetett lámpáktól, hogy a leivelési hajlamuk az ionszenyezés mennyiségettől függetlenül teljesen megszünjék. A lezárt rendszerbe került ionszenyezések ugyanis semmiféle kezelés hatására nem távoznak az izzólámpa belsőjéből, így - amennyiben hatásos lekötésükön megfelelő getteranyag nem gondoskodik - azok idővel ismét a volframspirálra kerülhetnek és ivelést okozhatnak. A váratlan ivképződés elkerülésének legmágbizhatóbb módja, amint több helyütt már említettük, csak az izzólámpa belsőjének ionszenyezésmennessége lehet.

Látható, hogy számos probléma vár még tisztázásra, következtetéseink egy részét pedig egyelőre ajánlatos munkahipotézisként kezelní a további részletek kérdések megoldásánál. Reméljük, hogy eddigi eredményeink közreadásával hozzájárulhatunk a jelenségek fizikai okainak jobb megismeréséhez, és a káros jelenség elhárításának elősegítésével a vákuumtechnikai iparág műszaki színvonalának fejlődéséhez is.

Végül e helyen is köszönetünket fejezzük ki mindenazonnak, akik munkánk eredményességeit tevékenyen segítségükkel, értékes tanácsaikkal hozzájárultak.

## IRODALMI UTALÁSOK

- [1] Clapp R.H.: Illuminating Engineering 1950. II. p. 357.  
Termikus emisszió gáztöltésű izzólámpában.
- [2] Minturn R.E. - Datz Sh. - Taylor E.H.: Journal of Applied Physics, Vol. 31. No. 5., p. 876-879 (May 1960). Thermal emission of alkali ion pulses from clean and oxygenated Tungsten.
- [3] Winter E. (EIVRT) 131.262 sz. magyar szabadalom 1941. II. 28. Eljárás gáztöltésű villamos izzólámpák előállítására.
- [4] Szelényi T.Z. - Szénfy E. 151.111 sz. magyar szabadalom 1962. VII. 24. (MA 1170). Eljárás izzólámpák kezelésére.
- [5] Winter E. - Szigeti Gy. - Szondy J. - Borsányi A.: magyar szabadalom (MA 1923) 1968. XIII. 11. Eljárás és berendezés izzólámpák kezelésére.
- [6] (EIVRT) megjelent 139.886 sz. magyar szabadalom (21f 31-44) 1949. Eljárás gáztöltésű izzólámpák előégetésére.
- [7] Pipkin M. (GEC) General Electric Review Vol. 52., No. 3., p. 14-17, (March 1949). A revolutionary development in incandescent lamps.
- [8] Buchanan A.G. (AEI) Transactions on the Illuminating Engineering Society (London) Vol. 29., No. 1., p. 15-17, (1964). Néhány szempont izzólámpák ivleégéséhez.

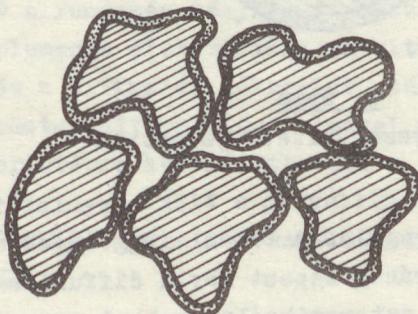
RÖNTGENDIFFRAKCIOS VIZSGÁLATI LEHETŐSÉG DIFFUZIOS  
FOLYAMATOK KÖVETÉSÉRE

NAGY Attila

MTA Műszaki Fizikai Kutató Intézet, Budapest

BEVEZETÉS

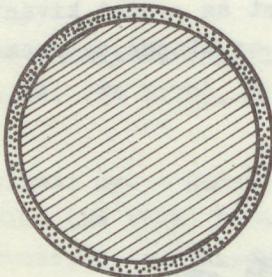
Jelen dolgozat az ELTE TTK Kisérleti Fizikai Tanszékén készült szakdolgozat [1] egyik gondolatának továbbfejlesztése. A szakdolgozat eredeti célkitűzése az aktivált szinterelés vizsgálata volt. Azt az esetet kívántuk vizsgálni, amikor az aktiváló anyag az alapanyag szemcséin vékony burkoló réteget képez.



1. ábra

Az aktivált szinterelés egy lehetséges geometriája.  
Az aktiváló anyag az alapanyag szemcséin vékony burkoló hártyát képez.

A matematikai egyszerűsítés céljából a szemcséket gömb alakunak tételeztük fel. Feltettük továbbá, hogy a szemcsék egy fcc rácsot töltenek ki. Ekkor bármely két szomszédos szemcse felezősíkja a rendszer tükörsíkja, így ezen a sikon az eredő anyagáramlás nulla lesz. További egyszerűsítésként a felezősíkokkal határolt testet gömbbel helyettesíthetjük: ez a gömb maga a szemcse. Igy egy magában álló gömbre kell megoldani a diffuziós problémát.



2. ábra

Az egyszerűsített geometria

Ha feltesszük, hogy a diffuziót a Fick egyenlet írja le, akkor ezen probléma megoldása Bessel függvényekre vezet, ezért a szemcse sugarához képest rövid diffuziós utakra ezt az elrendezést a matematikailag sokkal egyszerűbben kezelhető, sik lapok által határolt rendszerrel helyettesítjük.



3. ábra

Sik elrendezés. Rövid diffuziós utakra egyenértékű  
a gömbi elrendezéssel

Mivel magas hőmérsékletű kályha nem állt rendelkezésünkre, a diffuziót réz-nikkel próbatesteken vizsgáltuk. A 3. ábrán látható elrendezés tényleges elkészítése ( $0,1$  mm vastag Cu alaplemezre elektrolizissel vittünk fel  $5 \mu\text{m}$ -es Ni réteget), és a diffuziós hőkezelés után ( $500^\circ\text{C}$ -on 1 óra) készített röntgendiffrakciós felvétel tanulmányozása adta a most ismertetésre kerülő ötletet.

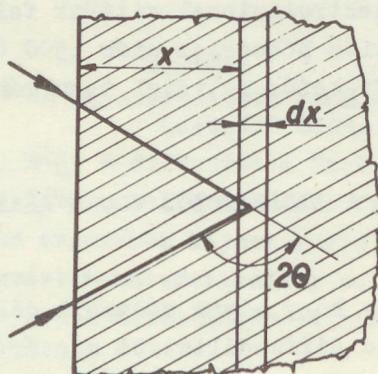
#### A DIFFUZIOS PROFIL ÉS A DIFFRAKCIOS VONAL ALAKJÁNAK ÖSSZEFÜGGÉSE

Célkitüzsünk az volt, hogy olyan módszert dolgozzunk ki, melynek segítségével a diffundáltatott mintáról készült röntgendiffrakciós vonal alakjából következtetni lehet a mintában lévő koncentrációeloszlásra. Erre akkor van remény, ha a diffundáltatott anyag a vizsgált koncentráció-tartományban az alapanyaggal szilárd oldatot képez. Ebben

az esetben a koncentrációkülönbségek rácsparaméter-különbségek formájában jelennek meg. A folyamatosan változó rácsparaméterű mintán keletkező diffrakciós vonal alakját az elhajlás dinamikus elméletéből Burgeat számította ki [2]. Mi a lényegesen egyszerűbb geometriai elméletet alkalmaztuk a vonalprofil meghatározására.

Gondolatmenetünk elhanyagolja az instrumentális vonalszélessédes hatását, ugyanis ez a tényleges vonalból hosszadalmasszámítással leválasztható, de sokkal célravezetőbb, ha a kísérleti körülmények gondos megválasztásával az instrumentális vonalszélességet minimálisra csökkentjük.

A fenti elhanyagolás figyelembevételével a vonal alakját a következőképpen lehet meghatározni. Tekintsünk egy, a felületen  $x$  távolságra lévő olyan  $dx$  vastagságú réteget, melyben a koncentráció, így egy adott  $hkl$  Miller index-hármashoz tartozó  $d$  siktávolság is állandónak vehető.



4. ábra

Az intenzitás meghatározásához.  
Magyarázat a szövegben

A fenti rétegről jövő reflexió helye a

$$2d \sin \theta = \lambda \quad (1)$$

Bragg egyenletből, az  $I^{\text{int}}$  integrált intenzitáshoz való hozzájárulása pedig a

$$dJ^{\text{int}} = J_0 e^{-\mu kx} dx \quad (2)$$

egyenletből határozható meg. Az utóbbiban  $\mu$  az átlagos lineáris abszorpciós koeficiens,  $k$  pedig egy geometriától függő konstanst jelent, míg  $J_0$  a felületi rétegről reflekált döntött röntgensugár intenzitása.

A diffraktométeres felvételen az intenzitás a  $\theta$  elhajlási szög függvényében változik. A (Bragg egyenletet felhasználva (2) egyenletet átirhatjuk a  $\theta$  differenciális kifejezésévé:

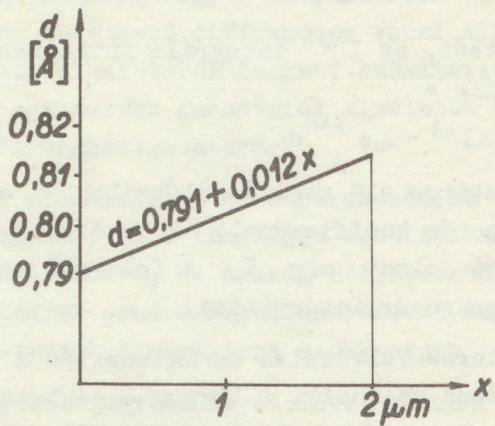
$$dJ^{\text{int}} = J_0 e^{-\mu kx} \frac{1}{\frac{\partial d}{\partial x}} \cdot \frac{\lambda}{2 \sin^2 \theta} \cos \theta d\theta \quad (3)$$

(A negatív előjel onnan ered, hogy  $\frac{\partial d}{\partial x}$  és  $d\theta$  mindenkor ellenkező előjelű.)

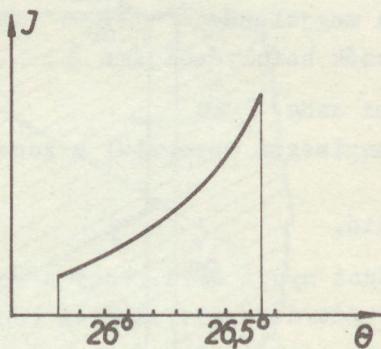
A diffraktogramon megjelenő  $I = \frac{dI^{\text{int}}}{d\theta}$  intenzitást tehát a következő tényezők befolyásolják:

- a.) az elhajlási szög,
- b.) a  $\frac{\partial d}{\partial x}$  mennyiségen keresztül a koncentrációs gradiens,
- c.) az abszorpció.

A (3) egyenlet módot nyújt arra, hogy a vonalprofilt meghatározzuk. Megfordítva: a diffrakciós vonal alakjából a rácsparaméter (azaz lényegében az ötvözött koncentrációja), mint a felszintől mért távolság függvénye meghatározható. Ez a számítás akkor végezhető el könnyen, ha a b.) és c.) tényezők közül az egyik elhanyagolható.



5/a ábra



5/b ábra

A rácssíkok távolságának változása és az elméleti vonalák abban az esetben, ha az abszorpciós effektus dominál.

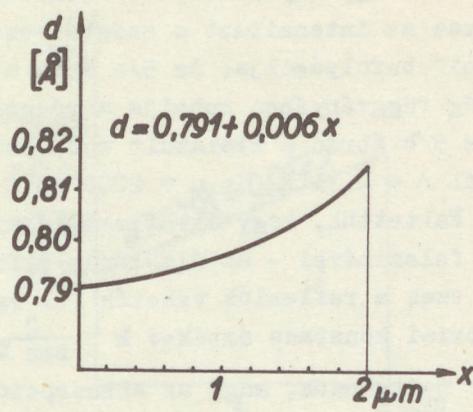
Példaként bemutatunk néhány elméletileg kiszámított vonalprofilt. Az 5. ábrán egy olyan helyzet látható, amikor  $\frac{\partial d}{\partial x} = \text{const}$ , azaz az intenzitást a szögtényezőkön kívül csak az abszorpció befolyásolja. Az 5/a ábra a felszintől mért  $x$  távolság függvényében mutatja a rácssíkok d távolságát, míg az 5/b ábrán a kialakult vonalprofil látható. A számításnál  $\lambda = 0,71 \text{ \AA}$  és  $\mu = 2000 \text{ cm}^{-1}$  értékeket használtuk fel. Feltettük, hogy a reflektáló siksereg párhuzamos a minta felszinével - az általános diffraktométeres technikával ezek a reflexiók vehetők fel egyszerűen -, így a  $k$  geometriai konstans értéke:  $k = \frac{2}{\sin Q}$ .

A másik példában feltesszük, hogy az abszorpciós jelenség elhanyagolható. Ez több esetben is bekövetkezhet:

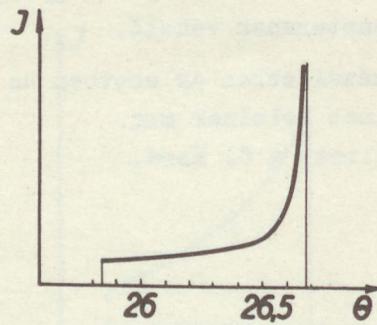
- a.) a használt sugárzásra kicsiny az abszorpciós koefficiens
- b.) a diffuziós nagyon vékony rétegre terjedt ki
- c.) a változó koncentrációju tartomány a minta belsejében foglal helyet. Ekkor az abszorpciós gyengítés a vizsgált rétegen konstansnak vehető.

Az intenzitás változásai ebben az esetben az  $\frac{\partial d}{\partial x}$  mennyiség változásainak felelnek meg.

Ezt az esetet szemlélteti a 6. ábra.



6/a ábra

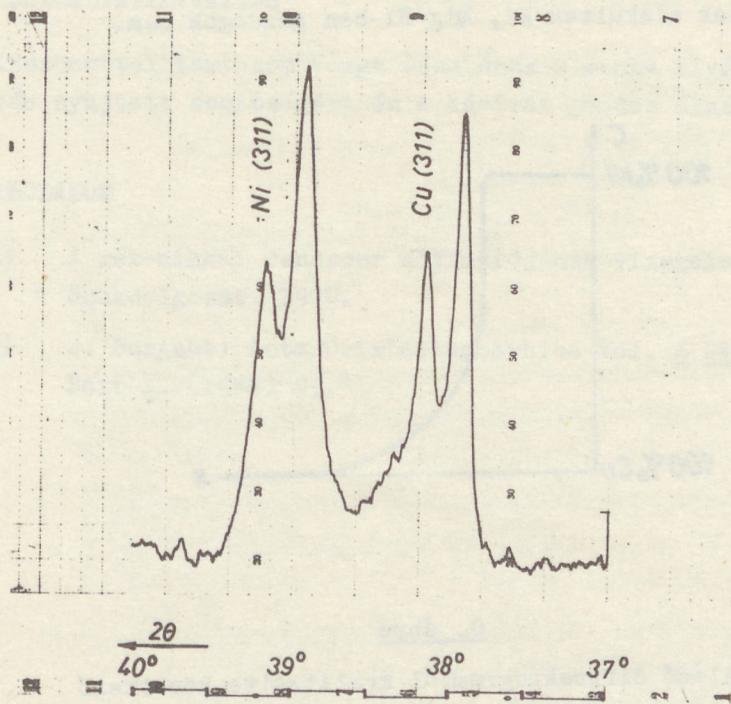


6/b ábra

A rácssíkok távolságának változása és az elméleti vonalalak abban az esetben, ha az abszorpció elhanyagolható.

## ELŐZETES MÉRÉSI EREDMÉNYEK

A fent ismertetett eljárásról W és Mo egykristályokban vég-bemenő diffuziós vizsgálatára kívánjuk alkalmazni. A meg-lévő Cu-Ni mintán előzetes mérést végeztünk. Mo K  $\alpha$  sugárzást használva felvettük a minta (311)-es reflexióját. Az eredményt a 7. ábra mutatja.

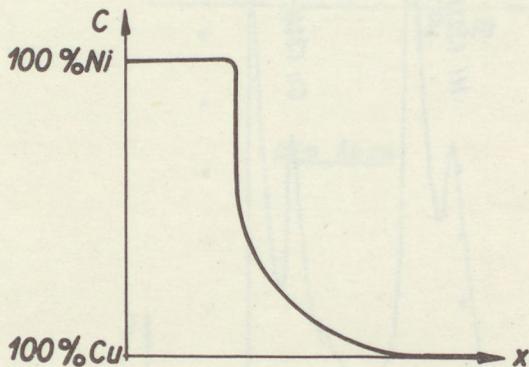


7. ábra

A diffundáltatott mintáról készült diffraktogram

A széles vonal miatt a felvétel kvantitatíve nem értékelhető ki kielégítő pontossággal. Megállapítható, hogy a felszín közelében lényegében tiszta Ni maradt. A tiszta réz vonala is megfigyelhető a felvételen. A két vonal között az intenzitás nem csökken le az alapszintre; ez folytonosan változó rácsparaméterű rétegre utal.

A vonalalak a Cu reflexió felé kevésbé meredek, mint a Ni felé. Ez azt jelenti, hogy a diffuziós során rézben gazdag ötvözetek alakultak ki, míg Ni-ben gazdagok nem.



8. ábra

Az előző diffraktogramból kvalitatíve következő koncentrációeloszlás

A koncentrációeloszlást kvantitatíve a 8. ábra szemlélteti. Az előzetes mérés kvalitatív eredménye reményt nyújt arra, hogy a sokkal élesebb reflexiókat adó egykristályok diffuziójá kvantitatíve is vizsgálható lesz.

## ÖSSZEFoglalás

A diffuziós profil a diffrakciós vonal alakjából a legegyszerűbb, geometriai elmélet alapján elvileg meghatározható. A vonal alakját az abszorpció és a koncentrációgradiens befolyásolja. Az előzetes mérések kvalitatív eredményt adnak.

## Köszönetszöveg

Köszönettel tartozom Varga Lászlónak a munka elvégzése során nyújtott segítségért és a kézirat gondos átnézéséért.

## Irodalom

- [1] A réz-nikkel rendszer diffuziójának vizsgálata.  
Szakdolgozat, 1970.
- [2] J. Burgeat: Acta Cristallographica Vol. A 24,  
Part 1. (1968) 99.

## MEGJELENT KIADVÁNYOK

O = Eredeti közlemények.

O - 1 Velocity and current determination for steadily travelling domains in semiconductors.

I. Recombination instability (1967)

II. Watkins-Gunn effect (1968)

Irta: dr. Pataki György

O - 2 Uj eredmények a volfrámkutatásban (1969)  
(Cikkgyűjtemény)

O - 3 Néhány probléma a félvezető kutatásban

Irták: Bodó Zalán

Schanda J.-Sass G.

Födör B.-Zsindely S.-Papp E.

Urhegyiné Vanyek M.

R = Összefoglaló tanulmányok

R - 1 Szilárd testek rácshibáinak láthatóvájtétele  
röntgen-topográfiai módszerekkel (1968)  
Irta: dr. Szántó István

R - 2 Epitaxiálisan növesztett félvezető rétegek  
fizikai paramétereinek mérése (1968)  
Irta: Gutai László .

R - 3 Kristályhibák keletkezése epitaxiális félvezető  
rétegekben (1968)  
Irta: dr. Székely Tamásné

- o o o -

A magyar elektroncsőipar szolgálatában.

Winter Ernő munkássága 1897-1967. (70. születésnapjának  
tiszteletére)

A magyar izzólámpaipar szolgálatában.

Millner Tivadar munkássága 1899-1969. (70. születésnapjának  
tiszteletére)

PAPERS IN THESE SERIES

O = Original Publications

O - 1 Velocity and current determination for steadily travelling domains in semiconductors

I. Recombination instability (1967)

II. Watkins-Gunn effect (1968)

O - 2 New results in tungsten research (1969)  
(Collective work)

O - 3 Some problems in semiconductor research

Papers presented by: Z. Bodó

J. Schanda - G. Sass

B-Pődör - S.Zsindely - E. Papp

U.M.Vanyek

R = Review Articles

R - 1 X-ray topography of lattice defects in solids (1968)  
By Dr. I.Szántó

R - 2 Measurement of the physical parameters of  
epitaxially grown semiconductor layers (1968)  
By L. Gutai

R - 3 Formation of lattice defects in epitaxial semi-  
conductor layers (1968)  
By Clara Székely

- o o -

Selected articles of the oeuvre of Professor E.Winter  
(1967) (In honour of his 70th birthday)

Selected articles of the oeuvre of Professor T.Millner  
(1969)(In honour of his 70th birthday)





